

证券代码：688182

证券简称：灿勤科技

江苏灿勤科技股份有限公司
2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案



二〇二六年七月

公司声明

1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编制。

3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议通过并取得有关审批机关的批准。

特别提示

1、本次向特定对象发行股票方案已经公司于 2026 年 7 月 15 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过，尚需获得公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后方可实施。

2、本次发行的发行对象为不超过 35 名符合中国证监会、上海证券交易所规定条件的特定投资者，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象由公司董事会及其授权人士根据股东会授权，在公司取得中国证监会对本次发行予以注册的决定后，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及本次发行申购报价情况，遵照价格优先等原则协商确定。若发行时国家法律、法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次发行的股票。

3、本次向特定对象发行股票采取询价发行方式，本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量，即“发行底价”）。若公司在定价基准日至发行日的期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行底价将进行相应调整。

本次发行通过询价方式确定发行价格，最终发行价格将由董事会及其授权人士根据股东会授权，在公司取得中国证监会对本次发行予以注册的决定后，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定，遵照价格优先等原则，根据发行对象申购报价情况协商确定，但不低于前述发行底价。

4、本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，即本次发行不超过 120,000,000 股（含本数）。最终发行数量将在本次发行获得中国证监会作出予以注册决定后，根据发行对象申购报价的情况，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若公司在审议本次向特定对象发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本等除权事项或者因股份回购、员工股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化，本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。

5、本次向特定对象发行股票完成后，特定对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次发行对象所取得上市公司向特定对象发行股票的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

6、本次发行的募集资金总额不超过人民币 85,100.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目	项目总投资	其中：拟使用募集资金投入
1	第六代信息技术研发及产业化项目	69,857.91	51,000.00
1.1	第六代信息技术产业化项目	49,821.67	35,000.00
1.2	高性能电子陶瓷器件研发项目	20,036.25	16,000.00
2	先进陶瓷封装产业化项目	20,632.31	17,000.00
3	信息化升级与数字化工厂建设项目	4,224.27	3,100.00
4	补充流动资金项目	14,000.00	14,000.00
总计		108,714.49	85,100.00

本次向特定对象发行募集资金到位前，公司可根据募集资金拟投资项目实际进度情况以自筹资金先行投入，待本次募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

本次向特定对象发行募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

7、本次向特定对象发行完成后，不会导致公司控制权发生变化，也不会导致公司股权分布不具备上市条件。

8、本次发行前公司滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

9、本次发行决议的有效期为自公司股东会审议通过之日起 12 个月。

10、公司积极落实《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》等规定的要求，结合公司实际情况，制定了《江苏灿勤科技股份有限公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》。本预案已对公司利润分配政策，尤其是现金分红政策的制定及执行情况、近三年现金分红金额及比例、未分配利润使用安排情况进行了说明，请投资者予以关注。

上述具体内容请详见本预案“第四节 利润分配政策及执行情况”之内容。

11、本次向特定对象发行股票完成后，随着募集资金的到位，公司的总股本和净资产规模将相应增加。由于募集资金投资项目的使用及实施需要一定时间，因此本次发行存在每股收益等指标在短期内被摊薄的风险。为保障中小投资者的利益，公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报的影响进行了认真分析，并制定填补被摊薄即期回报的具体措施。相关情况详见《江苏灿勤科技股份有限公司关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的公告》。特此提醒投资者关注本次发行摊薄股东即期回报的风险；同时，虽然公司为应对即期回报被摊薄风险而制定了填补回报措施，但所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。

12、公司本次发行前，前次募集资金为首次公开发行股票募集资金，募集资金净额为 97,426.60 万元，前次募集资金已于 2025 年 11 月使用完毕。

13、本次向特定对象发行股票方案最终能否获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会予以注册，以及最终取得审核通过及注册的时间存在较大不确定性，提请广大投资者注意。

14、董事会特别提醒投资者仔细阅读本预案“第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“六、本次股票发行相关的风险说明”有关内容，注意投资风险。

目 录

公司声明	1
特别提示	2
目 录	6
释 义	8
一、一般释义	8
二、专业释义	8
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	10
一、公司基本情况	10
二、本次向特定对象发行股票的背景和目的	10
三、本次发行的方案概要	14
四、本次发行是否构成关联交易	17
五、本次发行是否导致公司控制权发生变化	18
六、本次发行是否会导致公司股权分布不具备上市条件	18
七、本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序	18
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	19
一、本次募集资金的使用计划	19
二、本次募集资金投资项目可行性分析	19
三、本次募集资金运用对公司财务状况及经营管理的影响	40
四、本次募集资金投向属于科技创新领域	41
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	43
一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	43
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况	44
三、公司与实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况	44
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被实际控制人及其关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形	45
五、本次发行对公司负债情况的影响	45

六、本次股票发行相关的风险说明	45
第四节 利润分配政策及执行情况	49
一、公司利润分配政策	49
二、公司最近三年股利分配情况	52
三、公司最近三年未分配利润使用情况	53
四、公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划	53
第五节 本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报分析	58
一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	58
二、本次发行摊薄即期回报的风险提示	60
三、本次向特定对象发行股票的必要性和合理性	60
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	61
五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施	61
六、公司的董事、高级管理人员以及公司控股股东、实际控制人关于本次发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺	62

释 义

在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

一、一般释义

灿勤科技/本公司/公司/发行人	指	江苏灿勤科技股份有限公司
本次发行/本次向特定对象发行	指	江苏灿勤科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票之行为
本预案、预案	指	江苏灿勤科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案
灿勤管理	指	张家港灿勤企业管理有限公司，发行人股东
聚晶管理	指	张家港聚晶企业管理合伙企业（有限合伙），发行人股东
荟瓷管理	指	张家港荟瓷企业管理合伙企业（有限合伙），发行人股东
最近三年	指	2023 年、2024 年、2025 年
股东会	指	江苏灿勤科技股份有限公司股东会
董事会	指	江苏灿勤科技股份有限公司董事会
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
股票/A 股	指	面值为 1 元的人民币普通股
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《江苏灿勤科技股份有限公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

二、专业释义

介质波导滤波器	指	采用微波介质陶瓷材料制作本体，并在表面镀着导电金属层后形成的滤波器，相比广义的介质滤波器，其无电磁泄露，具有较高的品质因素、较低的损耗和较大的承受功率，并可根据谐振器矩阵式的排列方式满足较高的带外抑制性能
谐振器	指	产生谐振频率的电子元件，产生的谐振频率具有稳定、抗干扰性能良好的特点，广泛应用于各种电子产品中
金属腔体滤波器	指	使用金属材料制成金属谐振腔，并按一定的排列方式组成的滤波器
功分器	指	一种将一路输入信号能量分成两路或多路输出相等或不相等能量的器件
耦合器	指	将接收到的射频信号，按比例不均等地分成多路的器件，可用于信号的隔离，分离和混合等
负载	指	采用阻性材料吸收来自系统的微波能量并转化为热量耗散掉，改善电路的匹配性能，通常接在电路的终端的器件

衰减器	指	采用耦合器和同轴电缆结合设计的衰减器具有互调值低、功率容量较高、工作频带宽等特点
电桥	指	一种将两种频率相同的信号进行耦合成一路信号输出或者将一路信号均分为两路幅度相等正交信号的器件，可通过相关结构和工艺设计满足大功率、低互调、宽频带特性的要求
PCB	指	Print Circuit Board，即印制电路板或印制线路板
HTCC	指	High Temperature Co-fired Ceramic，高温共烧陶瓷
FDD	指	Frequency Division Duplexing，频分双工，是指上行链路（移动台到基站）和下行链路（基站到移动台）采用两个分开的频率工作，该模式工作在对称频带上
TDD	指	Time Division Duplexing，时分双工，上下行链路采用相同的频带，在一个频带内上下行占用的时间可根据需要进行调节，并且一般将上下行占用的时间按固定的间隔分为若干个时间段
Sub-6GHz 频段	指	450MHz-6000Mhz。根据 3GPP 协议规定，5G 网络主要使用两段频率，分别是 FR1 频段和 FR2 频段。其中，FR1 定义的是 450MHz-6000Mhz，也就是 Sub-6GHz 频段；FR2 定义的是 24250Mhz-52600Mhz，也被称为毫米波(mmWave)
4T4R，8T8R	指	基站拥有 4 个发射天线和 4 个接收天线或 8 个发射天线和 8 个接收天线的计算机网络技术

注 1：本预案中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据合并报表口径财务数据计算的财务指标。本预案中任何表格若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致

注 2：本预案涉及的我国经济以及行业的事实、预测和统计等信息，来源于一般认为可靠的各种公开信息渠道。本公司从上述来源转载或摘录信息时，已保持了合理的谨慎，但是由于编制方法可能存在潜在偏差，或市场管理存在差异，或基于其它原因，此等信息可能与国内或国外所编制的其他资料不一致

第一节 本次向特定对象发行股票方案概要

一、公司基本情况

公司名称	江苏灿勤科技股份有限公司
英文名称	Jiangsu Cai Qin Technology Co., LTD
股票上市地	上海证券交易所
股票代码	688182
股票简称	灿勤科技
注册资本	40,000 万元
法定代表人	朱田中
有限公司成立时间	2004 年 4 月 9 日
上市日期	2021 年 11 月 16 日
统一社会信用代码	913205927605187509
注册地址	江苏省苏州市张家港保税区金港路 266 号
办公地址	江苏省苏州市张家港保税区金港路 266 号
联系电话	0512-56368355
联系传真	0512-56368301
公司网址	www.cai-qin.com.cn
经营范围	研发、生产、销售电子陶瓷元器件、组件、无线电通讯产品、卫星导航模组,集成电路芯片及产品制造,集成电路芯片及产品销售,特种陶瓷制品制造,特种陶瓷制品销售,汽车零部件及配件制造,汽车零部件研发,机械零件,零部件加工,信息系统集成服务,自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、本次向特定对象发行股票的背景和目的

（一）本次向特定对象发行股票的背景

1、6G 通信产业化窗口临近

在 2022 年 6 月举行的国际移动通信标准化组织 3GPP（第三代合作伙伴计划）RAN#96 全会上，3GPP 正式定义了 U6G（6GHz 上半段，即 6425-7125MHz）授权频谱，频段号为 n104，明确了对应的网络/终端射频标准，为后续产业链研发 6GHz 产品提供标准依据。2023 年世界无线电通信大会决定，将 U6GHz 划拨用于授权移动业务，明确了 U6GHz 在国际电信联盟（ITU）框架下的 IMT（国际移动通信）定位。U6GHz 兼具覆盖范围广与容量大的双重优势，被称作“黄金频段”，成为 5G-A

演进和商用的关键频段。不仅如此，U6GHz 作为 5G-A 的 n104 频段，同时也是 6G 的核心候选频段，可实现代际复用，是运营商存量投资保护与 6G 平滑衔接的关键。到 2027 年起，U6G 将进入全面爆发期，成为 AI 时代大带宽业务、工业互联网、车联网的核心承载，同时为 6G 规模商用奠定坚实基础，开启移动通信的全新篇章。

“十五五”规划纲要明确指出“要前瞻布局未来产业，探索多元技术路线、典型应用场景、可行商业模式等，推动第六代移动通信（6G）等成为新的经济增长点”，2025 年 11 月，IMT-2030 推进组发布第一阶段关键技术试验结果，目前我国已顺利完成 6G 第一阶段技术试验，累计形成超 300 项关键技术储备，并全面启动第二阶段试验工作。中国移动、华为、中兴等产业链上下游企业完成多项 6G 新技术试验，为促进形成技术共识提供了重要的试验依据，进一步巩固了我国在 6G 领域的领先优势。2026 年 6 月 4 日，工信部发布组织开展 6G 创新发展部省协同试点专项行动的通知，提出到 2029 年，进一步激发地方和企业创新活力，形成一批自主创新的 6G 技术方案，培育一批前景可观的新型业务应用场景，涌现一批丰富多样的新型终端产品，为 6G 商用落地提供有力支撑。

当前，6G 标准研制和产业研发已进入实质性推进阶段，6G 通信将采用更高频段，对介质波导滤波器的频率覆盖范围、Q 值、插损等性能指标提出更高要求。与金属腔体滤波器相比，介质波导滤波器在 5G、5G-A、6G 通信应用领域具有独特优势，同等频率要求下，介质波导滤波器产品的体积更小、重量更轻。其体积小、重量轻、成本低、接口方式多样，能够适应滤波器定制化、个性化的发展趋势，随着第六代移动通信技术发展产业化落地，将带来巨大的市场需求。

2、HTCC 处于政策红利与市场需求双重驱动的发展期

HTCC 是一种将未烧结的流延陶瓷材料与高熔点金属浆料通过丝网印刷、叠层、压合、切割后，在高温下共烧结而成的多层陶瓷电路，具备高机械强度、高导热率、优异的化学稳定性、高绝缘性、出色的气密性以及接近硅片的热膨胀系数等核心优势。其产品形态主要包括多层陶瓷外壳、基板及结构件等，是航空航天、国防科工、激光与光通信、大功率半导体、新能源等关键领域的核心元件。

《“十四五”原材料工业发展规划》《基础电子元器件产业发展行动计划》等国家级文件，均将高端电子陶瓷材料列为发展重点，强调提升产业链供应链韧性，为 HTCC 行业的研发投入、产能扩张和市场拓展提供了强有力的政策支撑。《产业结

构调整指导目录（2024 年本）》将陶瓷基板列为鼓励类产业，《重点新材料首批次应用示范指导目录（2024 年版）》将氮化铝粉体、陶瓷件及基板、氮化硅基板等 HTCC 相关材料列为重点新材料。

随着万物互联时代的到来，电子系统整机对电路尺寸、密度、功能性、可靠性及功率均提出了更高的要求，因 HTCC 元器件及组件在尺寸、成本、功能、可靠性等方面能够满足电子系统整机对电路的诸多要求，在近几年获得了广泛的关注。在 AI 与高性能计算领域，随着 GPU 功耗激增，高导热陶瓷基板已成为全球 AI 巨头破解芯片散热瓶颈的刚需元件。随着新能源汽车、光伏储能行业的快速发展，IGBT 功率模块的需求快速增长，对于陶瓷基板的需求也不断增加。

3、顺应信息化趋势，加快数智化转型

2026 年 1 月，工业和信息化部、国家发展改革委、国家数据局联合印发《电子信息制造业数字化转型实施方案》，着力拓展电子信息制造业数字化转型、智能化升级的广度和深度，巩固电子信息制造业稳增长内生动力，不断提升电子信息技术和产品对其他行业数字化转型赋能力度，助力推动新型工业化和制造强国建设。实施方案明确提出，到 2027 年，电子信息制造业数字化转型、智能化升级的新型信息基础设施基本完善，规模以上电子信息制造业企业关键工序数控化率超过 85%，先进计算、人工智能深度赋能行业发展。到 2030 年，转型场景更加丰富，建立较为完备的电子信息制造业数据基础制度体系，电子信息制造业工业数据库基本建成，形成一批标志性智能产品，数字服务和标准支撑转型的环境基本完善，数字生态基本形成，转型效率和质量大幅提升，向全球价值链高端延伸取得新突破。

（二）本次向特定对象发行股票的目的

1、前瞻性布局，抢占下一代通信技术产业化先机

全球移动通信标准组织 3GPP（第三代合作伙伴计划）已于 2025 年启动 6G 国际标准制定，预计将于 2029 年完成第一版 6G 国际标准，并于 2030 年具备商用能力，全球各国与国际组织陆续出台 6G 相关举措，6G 技术布局与产业推进明显提速。

随着移动通信基站快速向多通道化、小型化、轻量化、低成本化、低功耗化的方向演进，介质滤波器凭借小体积、轻量化、高性能、低成本等特征正获得包括频谱重耕、5G-A、6G、NTN（商业航天非地面网络）等越来越多的应用场景和商业

机会。介质滤波器作为公司的优势产品和主力业务，公司在过去多年长期投入，巩固了介质滤波器产品线，目前持续保持了在技术能力、产能产量、市场份额等方面的领先地位，持续服务于国内外主要通信设备制造商。公司持续进行新品类开发、工艺改进、效益优化等工作，持续革新介质滤波器产品线，高性能介质波导滤波器能够覆盖 DC-U6G 频段，可以满足 6G 宏基站场景需求。通过第六代信息技术研发及产业化项目建设，公司将实现前瞻性的技术和产能布局，抢占下一代通信技术产业化先机，在 6G 通信产业化落地前形成大规模高质量的量产能力，确保在下游需求爆发时快速响应，保持行业领先地位。

2、契合高增长光通信用 HTCC 市场需求，推动国产替代

随着高端市场对 HTCC 元器件、陶瓷封装、大功率陶瓷基板等需求的增长，国内厂商也开始意识到 HTCC 技术的重要性和巨大的发展空间。在 HTCC 领域，国内厂商起步较晚，在技术积累方面也较为缓慢，导致 HTCC 产业与国外企业的差距较大，从全球市场份额来看，日本企业在粉体及基板方面占据绝对领先地位。由于 HTCC 行业技术门槛较高，目前仅有少数国内厂商在着手研发 HTCC 技术，形成批量供应能力的企业更是少数，技术能力和产量水平目前还远远不能满足国内相关领域的发展需求。此外，受国际贸易摩擦影响，HTCC 产品国产化替代的市场空间巨大。

公司自成立以来，一直深耕于电子陶瓷材料及射频器件产品技术的研发与生产，在电子陶瓷材料的制备工艺方面具有长期的技术积累，储备了 HTCC 产品所需的材料配方、印刷、金属化、共烧、测试等相关工艺技术，因此具有技术可实现性，部分生产设备也具有通用性。同时，公司积累了大量优质的客户资源，公司目前的诸多客户均在使用 HTCC 电子陶瓷产品，因此公司生产的 HTCC 电子陶瓷产品容易获取相应的市场资源和客户资源，同时将有利于进一步开拓新能源、半导体、消费电子等领域的新客户。

未来，随着 5G 应用、万物互联等市场的发展，对 HTCC 电子陶瓷产品的需求量会进一步增加。通过先进陶瓷封装产业化项目建设，公司将进一步提升 HTCC 产品的规模化制造能力与品质保障能力，进一步丰富公司高端电子陶瓷产品结构，加快高端 HTCC 产品国产化替代步伐，持续提升企业在细分领域的市场占有率与综合竞争实力。

3、提升公司研发能力与生产运营智能化水平

通信行业发展迅速，技术迭代较快，从 2G、3G、4G、5G 到 5G-A，每隔 5-10 年就会出现一次大规模的技术升级和更新迭代，因而对公司的研发能力和投入有较高要求，需要紧密跟踪电子陶瓷行业发展趋势，持续投入研发。通过高性能电子陶瓷器件研发项目建设，将进一步提升公司的技术水平和研发能力，在微波介质陶瓷材料、高功率介质波导滤波器、金属基陶瓷复合材料等方面积累技术经验，巩固技术优势，为公司增强持续盈利能力提供重要支持。

同时，通过信息化升级与数字化工厂建设项目，将提升公司生产运营方面的数字化、智能化水平，打造研发、生产、运营支撑数字化平台，实现设备自动化、数据采集、智能仓储、实验室管理、供应链协同等方面的优化提升，提高内部信息传递与决策效率，提升公司整体的运营管理能力。

4、优化公司资本结构，提升抗风险能力及盈利能力

随着公司的持续发展和未来业务规模的持续扩张，公司对营运资金的需求也将随之同步增加。公司拟通过本次向特定对象发行股票，有效补充日常经营所需的营运资金，从而增强资金实力、优化资本结构、降低资产负债率。募集资金到位后，公司资金实力将得到进一步增强，助力公司提高业务抗风险能力与持续经营能力，促进公司的长期可持续发展。

三、本次发行的方案概要

（一）发行股票种类及面值

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

（二）发行方式和发行时间

本次发行采取向特定对象发行方式，公司将在中国证监会作出予以注册决定的有效期内择机实施。

（三）发行对象及认购方式

1、发行对象

本次发行的发行对象为不超过 35 名符合中国证监会、上海证券交易所规定条件的特定投资者，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象由公司董事会及其授权人士根据股东会授权，在公司取得中国证监会对本次发行予以注册的决定后，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及本次发行申购报价情况，遵照价格优先等原则协商确定。若发行时国家法律、法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次发行的股票。

2、发行对象与公司关系

截至本预案公告之日，公司本次发行股票尚未确定发行对象，最终本次发行是否存在因关联方认购上市公司本次发行股份构成关联交易的情形，将在本次发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。

（四）定价基准日、定价原则及发行价格

本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量，即“发行底价”）。若公司在定价基准日至发行日的期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行底价将进行相应调整。调整方式如下：

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$

送股或转增股本： $P_1 = P_0 / (1 + N)$

两项同时进行： $P_1 = (P_0 - D) / (1 + N)$

其中， P_0 为调整前发行底价， D 为每股派发现金股利， N 为每股送股或转增股本数， P_1 为调整后发行底价。

本次发行通过询价方式确定发行价格，最终发行价格将由董事会及其授权人士根据股东会授权，在公司取得中国证监会对本次发行予以注册的决定后，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定，遵照价格优先等原则，根据发行对象申购报价情况协商确定，但不低于前述发行底价。

（五）发行数量

本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，即本次发行不超过 120,000,000 股（含本数）。最终发行数量将在本次发行获得中国证监会作出予以注册决定后，根据发行对象申购报价的情况，由公司董事会根据股东会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司在审议本次向特定对象发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本等除权事项或者因股份回购、员工股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化，本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。

若本次向特定对象发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以变化或调减的，则本次向特定对象发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减。

（六）限售期

本次向特定对象发行股票完成后，特定对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次发行对象所取得上市公司向特定对象发行股票的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

（七）股票上市地点

本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

（八）募集资金规模和用途

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 85,100.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目	项目总投资	其中：拟使用募集资金投入
1	第六代信息技术研发及产业化项目	69,857.91	51,000.00
1.1	第六代信息技术产业化项目	49,821.67	35,000.00
1.2	高性能电子陶瓷器件研发项目	20,036.25	16,000.00
2	先进陶瓷封装产业化项目	20,632.31	17,000.00
3	信息化升级与数字化工厂建设项目	4,224.27	3,100.00
4	补充流动资金项目	14,000.00	14,000.00
总计		108,714.49	85,100.00

本次向特定对象发行募集资金到位前，公司可根据募集资金拟投资项目实际进度情况以自筹资金先行投入，待本次募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

本次向特定对象发行募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

（九）本次发行前公司滚存未分配利润的安排

本次发行前公司滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

（十）本次发行决议有效期

本次发行决议的有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

四、本次发行是否构成关联交易

截至本预案公告之日，本次发行尚未确定发行对象，因而无法确定本次发行是否构成关联交易。最终本次发行是否存在因关联方认购上市公司本次发行股份构成关联交易的情形，将在本次发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。

五、本次发行是否导致公司控制权发生变化

截至本预案公告日，公司的控股股东为灿勤管理，灿勤管理持有发行人 145,580,452 股股份，占发行人总股本的 36.40%。公司的实际控制人为朱田中、朱琦和朱汇，朱田中与朱琦、朱汇为父子关系。朱田中、朱琦、朱汇合计直接持有发行人 28,500,009 股股份，占发行人股份总数的 7.13%；朱田中持有灿勤管理 96.20% 的股权并担任其执行董事兼总经理，通过控制灿勤管理控制其持有的发行人 36.40% 的股份；朱汇担任聚晶管理的执行事务合伙人，通过控制聚晶管理控制其持有的发行人 21.06% 的股份；朱琦担任荟瓷管理的执行事务合伙人，通过控制荟瓷管理控制其持有的发行人 3.36% 的股份。朱田中、朱琦、朱汇合计控制发行人 67.95% 的股份。自上市以来，公司控股股东及实际控制人未发生变动。

本次发行的股票数量不超过 120,000,000 股（含本数），若按本次发行数量的上限（即 120,000,000 股）测算，并且公司实际控制人均不参与本次发行，则预计本次发行完成后，公司总股本将由发行前的 400,000,000 股增加到 520,000,000 股，朱田中、朱琦、朱汇合计控制公司表决权的比例为 52.27%，仍为公司实际控制人。

本次向特定对象发行股票不会导致公司的控制权发生变化。

六、本次发行是否会导致公司股权分布不具备上市条件

本次向特定对象发行不会导致公司股权分布不具备上市条件。

七、本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序

（一）本次发行已取得的批准

本次向特定对象发行股票方案已经公司于 2026 年 7 月 15 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过。

（二）本次发行尚需履行的批准程序

根据相关法律法规的规定，本次发行尚需获得公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后方可实施。

第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金的使用计划

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 85,100.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目	项目总投资	其中：拟使用募集资金投入
1	第六代信息技术研发及产业化项目	69,857.91	51,000.00
1.1	第六代信息技术产业化项目	49,821.67	35,000.00
1.2	高性能电子陶瓷器件研发项目	20,036.25	16,000.00
2	先进陶瓷封装产业化项目	20,632.31	17,000.00
3	信息化升级与数字化工厂建设项目	4,224.27	3,100.00
4	补充流动资金项目	14,000.00	14,000.00
总计		108,714.49	85,100.00

本次向特定对象发行募集资金到位前，公司可根据募集资金拟投资项目实际进度情况以自筹资金先行投入，待本次募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

本次向特定对象发行募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

二、本次募集资金投资项目可行性分析

（一）第六代信息技术研发及产业化项目

1、第六代信息技术产业化项目

（1）项目概述

本项目实施主体为江苏灿勤科技股份有限公司，项目建设周期 3 年，实施地点位于张家港市后塍街道长山路 68 号，项目计划总投资 49,821.67 万元，其中拟使用募集资金投入 35,000.00 万元，主要包括工程建设投资、设备购置费用、软件投入费用、项目预备费、铺底流动资金等必要投资。

本项目依托现有成熟工艺体系与业务根基开展产能建设与技术升级，通过搭建专业化生产平台、扩充先进产线及检测设备，进一步优化生产条件，匹配 6G 产品与宇航级元器件的高标准要求。项目实施将有效释放产能潜力，持续巩固并提升市场地位，全面增强企业在高端通信滤波器领域的综合实力。

（2）项目实施的必要性

①适配通信技术迭代趋势，前瞻布局是维持领先地位的战略选择

全球通信技术正从 5G 向 6G 加速迭代演进，通信系统全面朝着超高速、超低时延、超宽连接、空天地一体化方向升级，对射频前端器件的综合性能提出了更高标准。陶瓷介质波导滤波器凭借高 Q 值、低插损、小型化、耐高温、抗干扰等突出优势，成为 6G 宏基站、小基站、卫星通信、车载通信等核心场景的刚需核心部件，下游市场刚需持续释放，行业整体产能需求迎来爆发式增长。通信技术的代际迭代不仅是技术升级的过程，更是市场产能格局重构的过程，企业唯有提前完成产能配套、实现规模化生产布局，才能承接新一轮行业增量需求，稳固市场领先席位。

公司作为全球 5G 陶瓷介质波导滤波器核心供应商，长期深耕微波介质陶瓷材料与射频器件赛道，在材料配方、产品结构、生产工艺、质量管控等领域积累了成熟的技术经验和规模化生产能力，同时依托长期合作的优质客户资源，构建了稳固的行业竞争壁垒。随着 6G 技术逐步落地商用、下游设备量产节奏持续加快，现有产能规模已无法匹配未来市场增量需求。基于现有成熟的技术和生产基础，针对性开展产能扩建、产线升级与量产能力优化，能够将公司既有的行业领先优势转化为规模化供货优势，顺利承接 6G 市场订单，持续稳固行业头部地位。

本项目实施将推动公司精准对接 6G 通信市场增量需求，完成 6G 陶瓷介质波导滤波器产能的规模化布局，实现从 5G 产能配套到 6G 批量量产的代际升级，补齐高端产品产能短板，持续巩固公司在全球陶瓷介质滤波器领域的产能优势与市场优势，保障企业在通信技术迭代、市场需求扩容的浪潮中，持续保持稳定的核心竞争力与市场占有率。

②行业呈现窗口期卡位特征，率先入局获得长期供货资格

通信射频器件行业具有显著的窗口期卡位效应，下游通信设备制造商对核心零部件的准入标准严苛、批量供货验证周期长，供应链合作粘性极强，一旦完成核心

供应商体系的认定，企业可在设备全生命周期内获得稳定、持续的批量订单合作。当前处于 6G 方案定型、设备预研、产业化落地的关键窗口期，下游头部设备厂商在锁定合格供应商的基础上，重点筛选具备规模化生产能力、稳定批量交付能力、充足产能储备的零部件企业开展深度绑定合作。能够提前完成产能布局、具备 6G 产品批量供货条件的企业，可顺利切入核心供应链白名单，在未来 6G 规模化商用、市场需求集中释放阶段，抢占稳固的市场份额与供货席位。若错失当前产能卡位窗口期，后续即便产品性能达标，也会因产能储备不足、量产配套滞后，面临准入门槛更高、导入周期更长、市场竞争更白热化的困境，难以切入主流供应链体系。

当前全球 6G 产业链正从技术标准攻坚逐步转向产业化、规模化落地的筹备阶段，行业产能格局尚未固化，是企业依托产能优势抢占高端市场、扩大市场占有率的关键战略机遇期。公司长期与全球主流通信设备厂商建立了深度、稳定的战略合作关系，产品品质、交付能力、配套服务均得到客户高度认可，具备绝佳的供应链卡位基础。依托成熟的产品体系和稳固的客户合作壁垒，公司可快速匹配客户 6G 批量采购需求，拥有优先获取客户量产订单、锁定大额供货份额的核心优势。

本项目实施将聚焦第六代信息技术的产能扩容与量产能力升级，全面提升公司高端产品规模化生产、标准化交付、大批量稳供的核心能力，快速匹配下游客户 6G 设备量产配套需求，提前深度绑定核心客户供应链体系，锁定长期稳定的批量供货资格。通过前瞻性的产能布局，补齐 6G 高端产品产能缺口，筑牢规模化交付优势，构建长期稳固的供应链合作壁垒，为后续 6G 全网规模化商用、海量市场订单落地提供坚实的产能与市场保障。

③实现产能分流，保障多品类业务协同发展

6G 用介质波导滤波器在尺寸精度、材料均匀性、高频性能一致性等方面有着严苛制造要求，相较于 5G 产品，其对工艺稳定性、量产良率与产品一致性的标准全面提升。当前厂区现有生产资源需保障传统通信器件稳定产出，若依托现有产线继续扩充 6G 产品产能，将挤占有限的生产资源、打乱生产排布，进而影响原有产品的正常生产与订单交付。为兼顾各类业务稳步发展，规避产能挤占引发的生产矛盾，本次规划新建专属生产线开展 6G 产品扩产。通过产能分区、专线生产的模式，既能持续放大 6G 产品产能规模、充分对接市场增量需求，也能保障原有产线稳定运转，维持既有业务的产出与供货能力。同时专线化生产可结合 6G 产品特性优化工

艺布局与设备配置，进一步提升产品品质与生产效率，实现新旧业务双线并行、同步增效，全面夯实企业整体生产运营与市场供货的综合保障能力。

随着通信产业迭代升级，下游市场对 6G 高端射频器件的采购需求持续攀升，市场订单呈现规模化、集中化特征，对产品交付时效、批量品质提出了更高要求。原有产线受场地、设备、生产排班等条件限制，难以在不影响现有业务的前提下承接大批量 6G 产品订单，产能瓶颈逐步凸显。新建专业化产线后，可针对 6G 产品的工艺特点打造独立完整的生产体系，从粉体处理、成型烧结到精密加工、性能检测全流程进行专项优化，最大化发挥工艺与设备效能，不仅能够快速释放新增产能，高效响应市场增量订单，还能让不同品类产品在专属产线上实现专业化、精细化生产，有效降低混线生产带来的工艺切换成本、品质波动风险，助力企业在稳固现有市场基本盘的同时，抢抓 6G 产业发展机遇，持续提升整体市场竞争力与可持续发展能力。

（3）项目实施的可行性

①国家政策大力支持，为项目发展提供保障

6G 通信技术研发已上升为国家科技竞争的战略制高点。“十五五”规划明确将第六代移动通信（6G）列入前瞻布局的未来产业重点方向，作为培育新质生产力的核心抓手。工信部 IMT-2030（6G）推进组已将太赫兹通信、空天地一体化网络、通感算融合列为 6G 核心关键技术方向，预计 2027—2028 年完成 6G 标准冻结、2030 年前后实现商用部署。与此同时，卫星互联网作为 6G 空天地一体化网络的核心组成，已被纳入国家“新基建”范畴——中国卫星网络集团有限公司（中国星网）统筹低轨宽带卫星星座建设，2025 年进入规模化部署阶段，远期规划超 1.2 万颗卫星，对标 SpaceX 星链形成自主可控的低轨通信星座体系。2025 年国务院发布的《关于进一步促进民间投资发展的若干措施》进一步明确鼓励民营企业进入商业航天全产业链，商业航天发射频次已从 2020 年的约 40 次/年攀升至 2025 年的突破 100 次/年，直接拉动星载电子元器件需求。

本项目产品直接对接星网工程与 6G 基站两大国家战略方向，属于《产业结构调整指导目录》中鼓励类的“频率元器件——微波介质陶瓷滤波器”及“卫星通信有效载荷”范畴，同时符合工信部《基础电子元器件产业发展行动计划》提出的“提升高频高速电子元器件自主供给能力”政策要求。项目在产业准入、环保审批、用地规

划等维度不存在实质性政策障碍，政策风险低、合规基础扎实，具备明确的政策先导性。

②技术与工艺储备充分，产业化落地具备坚实基础

本公司已建立 180 余种介质陶瓷粉体配方的研发数据库（80 余种已商业化量产），介电常数覆盖 4-150 的宽范围，可满足从 sub-6GHz 至 110GHz 的各类介质陶瓷元器件需求。6G 地面基站与低轨卫星通信的主要工作频段（Ku/Ka/Q/V 频段）均落在公司现有材料体系的覆盖范围之内，太赫兹频段（100GHz+）的材料开发虽需进一步研发投入，但已有的高频材料配方积累与烧结工艺基础可大幅缩短开发周期。公司已建成从陶瓷粉体制备、干压成型、高温烧结、金属化到调试的全产业链能力，产品良率超 95%，烧结良率超 99.3%，6G 频段滤波器的核心工艺路径与 5G 产品保持一致，技术升级主要为关键工序的设备精度提升与在线检测系统智能化改造，风险可控。

在星载环境适应性方面，公司深度参与“天问一号”“北斗”等国家重大航天工程配套，产品已通过热真空、辐照、力学振动等航天级环境试验验证，在宇航级产品可靠性设计、失效模式分析（FMEA）、批次可追溯性管理等方面已建立成熟的质量保障体系，可为本项目星载滤波器批量供货提供品质管控基础。此外，公司围绕核心技术与工艺已形成完善专利组合，并与科研机构保持密切产学研合作，6G 与星载滤波器在核心材料及基础工艺层面不存在根本性技术断档，两类产品在核心材料与基础工艺上技术衔接顺畅，相关产品已完成实验室验证并实现小批量供货，正式迈入市场化阶段。

③与现有业务高度协同，项目拓展具备先发优势

6G 用介质波导滤波器与公司现有 5G 通信用陶瓷介质波导滤波器在材料体系、制造工艺、测试体系三大维度具有高度技术同源性，本项目属于现有业务的技术升级与产能延伸，现有研发团队、生产设备、质量管理体系、供应商资源均可复用，大幅降低项目启动成本与技术试错风险。公司已建成从陶瓷粉体到元器件成品的全产业链能力，粉体自研自产可降低原材料成本，新增产能将进一步放大规模效应，形成“扩产→降本→份额提升→进一步扩产”的正反馈循环。

在客户与市场端，公司已与全球头部通信设备商建立多年深度合作关系，公司可基于现有客户网络高效切入新市场。公司深度参与“天问一号”“北斗”“星网”等国家重大工程积累的航天配套资质，为项目产品进入航天供应链提供了天然信用背书。此外，公司地处苏州张家港，市域及长三角区域汇集科研院所、高等院校等顶尖产学研资源，依托完善的电子陶瓷产业链生态圈与稳定成熟的核心技术团队，其中核心人员长期深耕微波介质陶瓷领域，为项目推进筑牢人才与产业协作保障。

因此，项目与公司现有 5G 滤波器业务技术、工艺、体系高度同源，可充分复用现有产能、团队及供应链资源，成本与技术风险可控，且具备全产业链及工艺协同优势，规模生产效益突出。同时，公司拥有全球优质客户资源与航天配套资质，客户认证周期短、市场导入能力强，同时依托优质区位产学研及资深技术团队，可充分保障项目顺利投产、高效运营。

（4）项目投资概算

本项目总投资金额为 49,821.67 万元，拟使用募集资金投入金额为 35,000.00 万元。项目总投资具体资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	其中：拟使用募集资金投入
1	工程建设投资	35,007.54	25,000.00
2	设备购置费用	4,355.00	4,000.00
3	软件投入费用	280.00	-
4	项目预备费	1,982.13	1,000.00
5	铺底流动资金	8,197.01	5,000.00
合计		49,821.67	35,000.00

（5）项目经济效益分析

经可行性论证及项目收益测算，本次募集资金投资项目具有良好的经济效益。项目实施后，公司将显著增强 6G 核心射频器件的整体供货实力，进一步稳固并拓展在主流通信设备供应链中的合作份额，有力支撑国内 6G 通信关键器件国产化推进步伐，为公司带来稳定的收入增长和现金流入。

（6）建设期限以及实施主体

本项目建设期为 36 个月，实施主体为江苏灿勤科技股份有限公司。

(7) 项目涉及的备案、环评等事项

截至本预案公告日，本募投项目备案及环评审批等手续尚在办理中，预计项目报批手续取得不存在实质性障碍。

2、高性能电子陶瓷器件研发项目

(1) 项目概述

本项目实施主体为江苏灿勤科技股份有限公司，项目建设周期 3 年，实施地点位于张家港市后塍街道长山路 68 号，计划总投资 20,036.25 万元，其中拟使用募集资金投入 16,000.00 万元，主要包括工程建设投资、设备投入、软件投入、项目预备费、人员投入等必要投资。

本项目依托公司多年技术积淀开展新材料、新工艺研发，持续筑牢技术壁垒，全面提升研发实力与核心竞争力，完全契合国家关键基础材料自主可控、电子信息产业转型升级的政策导向与行业发展大势。

(2) 项目实施的必要性

①完善公司电子陶瓷材料体系与产品布局，支撑企业长期可持续发展

公司自成立以来始终专注于微波介质陶瓷元器件的研发、生产与销售，目前已形成以介质波导滤波器、介质谐振器、介质天线等为主的产品体系，在 5G 通信基站用介质滤波器领域形成较强的市场竞争力。但放眼长远发展，公司现有业务结构仍存在优化空间，材料体系与应用场景较为集中，面向新一代通信、半导体、航空航天、车载电子、工业物联网等新兴领域的高端材料与配套产品布局仍有欠缺。随着全球信息技术加速向 5G-A、6G、万物互联、卫星通信、半导体、航空航天、车载智能硬件、工业物联网等领域延伸，下游市场对电子陶瓷材料的高频化、微型化、集成化、高可靠性提出越来越高的要求，若仅依赖传统移动通信业务，已难以充分把握多场景、多领域、多元化的市场机遇，也难以支撑公司持续保持高速增长。

本次项目立足企业长远战略，对现有材料与产品体系进行升级拓展，丰富高端电子陶瓷品类与元器件产品研发，搭建起“基础材料—核心器件—集成模组”一体化

业务架构。推动公司业务从传统移动通信领域，向多个高价值新兴领域延伸，有效优化业务结构、分散经营风险，全面提升企业综合实力与可持续发展能力。

②强化电子陶瓷领域核心竞争力，巩固行业技术领先地位

公司作为国内少数兼具微波介质陶瓷全流程研发与制造能力的企业，已在行业内建立起一定的技术优势与品牌影响力，是国家级专精特新“小巨人”企业、全国制造业单项冠军企业。但当前全球电子陶瓷技术迭代加速，国际厂商持续在材料配方、精密制造、器件集成、高频性能等方面构筑更高技术壁垒，国内同行业公司也在不断加大研发投入、加快产能扩张，尤其在新型功能材料、微纳工艺、高端射频器件等细分赛道竞争持续加剧，行业技术竞争日趋激烈。若公司不能持续提升材料研发能力、优化工艺技术水平、拓展高端产品布局，将面临技术升级滞后、高端市场拓展不足、原有竞争优势逐步弱化的风险，难以在未来更高水平的国际国内竞争中保持领先。

本项目聚焦行业核心技术痛点，重点攻关陶瓷粉体制备、精密成型烧结、低成本低损耗金属化、三维 MEMS 微纳加工、大功率器件设计等关键工艺与技术，持续提升企业原创研发、精密制造与系统集成能力，扩充自主知识产权储备，助力公司拉大国内同行技术差距、缩小与国际龙头的差距，筑牢技术壁垒，稳固国内龙头地位，向全球电子陶瓷第一梯队迈进。

③响应国家创新驱动发展战略，推动电子陶瓷关键基础材料产业升级

电子陶瓷材料是支撑 5G 通信、新一代信息技术、高端装备、半导体、航空航天等战略性新兴产业发展的“关键基础材料”，是推动产业链现代化、保障产业链供应链安全的核心环节。目前我国高端产品与技术对外依存度较高，国防科工、车载射频、工业物联网等高端领域供给不足，制约了相关产业链高质量发展。国家高度重视关键基础材料自主可控，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》进一步明确，将先进基础材料、新一代移动通信（5G-A/6G）、卫星互联网、低空经济、高端装备等列为“十五五”时期重点发展领域，要求深入实施产业基础再造工程，集中力量突破一批“卡脖子”核心技术，加快实现高水平科技自立自强。

本项目紧扣国家“十五五”开局的战略部署，立足高端电子陶瓷国产化替代目标，突破高端陶瓷粉体配方、高精度制造、高性能器件开发等关键瓶颈，打破国外技术

垄断与专利壁垒，提升我国电子陶瓷基础材料自主保障能力与核心元器件配套能力，推动我国电子陶瓷产业向高端化、自主化、国际化升级，重点支撑 6G 通信、卫星互联网、半导体封装等前沿领域突破，为我国新一代信息产业、半导体产业与高端装备产业高质量发展提供坚实支撑。

（3）项目实施的可行性

①充足的研发投入与完善的管控体系提供资金制度保障

公司始终将技术创新作为企业发展的核心驱动力，建立常态化稳步增长的研发投入机制，近年年均研发投入占营收比例处于 5%-10% 区间，逐年递增的研发经费，为新材料攻关、设备升级和人才引进筑牢资金根基。公司经营现金流充裕，依托自有资金可足额保障本项目落地所需设备采购、实验耗材、软件购置、新增人员薪酬等各项开支，全面支撑本次新材料、新工艺、新器件的研发工作有序实施。

公司实行分课题项目化管控模式，围绕全部研发任务设立专项攻关小组，严格执行需求评审、项目立项、样品试制、设计定型的全流程管理制度，各研发节点分层验收，精准把控试验进度、技术指标与经费耗用。按照材料、器件、工艺三大方向划分研发单元，统筹配置箱式烧结炉、PVD 镀膜设备、精密成型设备及 ANSYS 仿真软件等软硬件资源，实现研发资源按需调配。

充裕的资金保障、精细化项目管理制度、完备的软硬件配套以及常态化产学研协同机制，有效规避项目研发不确定性，为各项课题按期完成试验、指标达标与技术定型提供全方位支撑。

②深厚的技术积累与创新基础，为项目技术攻关提供核心支撑

公司深耕电子陶瓷领域二十余年，始终坚持自主创新，已构建起从“陶瓷粉体配方—精密成型—高温烧结—金属化—器件组装—测试验证”的全流程自主研发与制造体系，形成深厚且难以复制的技术积淀。公司现已掌握 180 余种介质陶瓷粉体配方，部分新型材料与器件已进入小批量试制及工艺优化阶段，依托现有成熟工艺可快速推进迭代升级；其余处于实验室研究阶段的前沿材料、微纳工艺、新型器件等研发内容，凭借公司射频仿真、精密加工、陶瓷金属化等技术积累，能够稳步开展配方与工艺探索，大幅缩短研发试错周期。截至 2025 年 12 月 31 日，公司参与制

订 1 项国家标准、7 项行业标准，累计取得专利 150 项，其中授权发明专利 52 项、实用新型专利 98 项，是国内少数具备电子陶瓷全链条技术能力的企业。

同时公司与科研院所、高等院校建立了长期稳定的产学研合作体系，积累了丰富的协同研发经验，有效夯实了企业自主创新能力。本项目以公司自主研发为核心，依托自身成熟的技术体系、研发团队与试制测试条件，独立完成课题的研发、工艺优化与产品定型工作。高校资源仅作为技术补充支撑，针对项目前沿技术难点提供学术与技术支持，降低研发风险、提升研发效率，为公司高质量完成本项目研发任务提供可靠保障。

③拥有高层次专业技术团队，为材料研发与技术攻关提供人才保障

公司经过长期发展与人才沉淀，已打造一支结构合理、经验丰富、专业齐全、核心骨干从业二十年以上的高层次技术团队，覆盖材料配方、粉体工程、陶瓷工艺、精密制造、射频设计、测试验证、品质管控等全链条领域。截至 2025 年 12 月 31 日，公司研发人员达 155 人，占员工总数 11.58%，其中本科及以上学历 91 人，占研发人员比例 58.71%，团队整体专业素养突出、技术功底扎实。结合本项目研发任务规划，公司计划新增材料、结构、射频、工艺等各类研发人员 73 名，按技术方向分组定岗，全面匹配本次研发工作需求。

同时，公司建立完善的研发项目管理体系、多层次人才激励机制与稳定的产学研合作机制，通过员工持股平台、绩效激励、专项奖励等方式激发创新活力，持续吸引材料、电子、机械等领域高端人才加入，为技术创新提供持续动力。依托成熟的人才培养体系与核心技术人员梯队，公司实现关键技术自主可控、研发力量稳定可靠。这支稳定、专业、实战经验丰富的技术团队，能够高效支撑高端陶瓷材料开发、工艺优化、产品迭代与落地，为项目顺利实施、技术突破、成果转化提供强有力、可持续的人才保障。

(4) 项目投资概算

本项目计划总投资额为 20,036.25 万元，拟使用募集资金投入金额为 16,000.00 万元。项目总投资具体资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	其中：拟使用募集资金投入
----	------	------	--------------

1	工程建设投资	14,758.10	14,000.00
2	设备投入	2,586.00	2,000.00
3	软件投入	203.40	-
4	项目预备费	877.38	-
5	人员投入	1,611.37	-
合计		20,036.25	16,000.00

（5）项目经济效益分析

本项目不直接产生经济效益，项目将进一步提升公司研发创新实力，优化研发与中试环境、升级精密检测平台，补齐高端材料专用试制条件短板，全面提升研发实力与创新效率，巩固公司在电子陶瓷与微波器件领域的技术领先优势。

（6）建设期限以及实施主体

本项目建设期为 36 个月，实施主体为江苏灿勤科技股份有限公司。

（7）项目涉及的备案、环评等事项

截至本预案公告日，本募投项目涉及的相关手续尚在办理中，预计项目报批手续取得不存在实质性障碍。

（二）先进陶瓷封装产业化项目

1、项目概述

本项目实施主体为江苏灿勤科技股份有限公司，项目建设周期 3 年，实施地点位于江苏省张家港保税区金港路 266 号，计划总投资 20,632.31 万元，其中拟使用募集资金投入 17,000.00 万元，主要包括工程建设投资、设备购置费用、项目预备费、铺底流动资金等必要投资。

本项目是在公司现有成熟工艺体系与业务基础上实施的产能扩建与技术升级。通过新建专业化生产产线、配套先进生产及检测设备，进一步提升 HTCC 产品的规模化制造能力与品质保障能力，满足下游客户对高端封装器件的严苛标准。项目落地后，能够有效缓解当前 HTCC 业务产能不足的现状，充分释放技术与客户优势，进一步丰富公司高端电子陶瓷产品结构，加快高端 HTCC 产品国产化替代步伐，持续提升企业在细分领域的市场占有率与综合竞争实力。

2、项目实施的必要性

（1）契合下游光通信市场需求，顺应产业链发展趋势

当前全球光通信行业正处于高速发展的黄金时期，作为产业链中游核心环节的光模块领域，在数据中心建设、5G/5.5G 网络升级、人工智能算力需求爆发等多重因素共同驱动下，市场规模持续扩大。而 HTCC 凭借其结构强度高、热导率高、化学稳定性好和布线密度高等突出优点，已成为光模块中激光器、探测器等核心光电组件封装的主流技术方案，其市场需求呈现爆发式增长态势。Business Research 调研数据显示，2026 年，全球 HTCC 陶瓷基板市场规模预计为 3.4 亿美元，预计到 2035 年该市场将达到 7.6 亿美元，年复合增长率约为 9.31%。QYResearch 的数据显示，在产品分类方面，HTCC 封装管壳占有重要地位，占有大约 70.6% 的市场份额，之后是 HTCC 封装基座，大概占比 22.73%。从下游应用拆分来看，射频微波器件、航空航天、汽车电子、光通信封装、工业大功率半导体为 HTCC 管壳五大核心应用场景，多赛道需求同步高速增长。

随着国内高端电子产业链自主可控进程加速、国内下游终端厂商产能持续扩容，各行业对高可靠 HTCC 陶瓷管壳的订单总量、产品一致性及极端工况性能要求进一步提高。从产业发展趋势来看，下游各类电子器件正朝着小型化、高功率、高频工作、宽温域、高气密可靠性的方向迭代，对 HTCC 封装管壳的材料性能、精密加工、封装可靠性提出更为严苛的标准，高性能 HTCC 陶瓷管壳已经成为制约高端电子装备产业化落地的关键零部件之一。

因此，本项目聚焦 HTCC 陶瓷管壳，契合多领域终端市场增量需求，顺应电子陶瓷封装行业向高精密、高可靠、规模化量产的产业链发展趋势，是公司深耕 HTCC 细分赛道、把握全行业市场机遇、拓展民用业务边界的核心战略举措。

（2）突破核心技术瓶颈，填补高端 HTCC 产品国产替代空白

从全球市场份额来看，QYResearch 调研数据显示，近几年日本占有全球大约 69% 的市场份额，是全球最大的生产商，核心厂商为京瓷、NGK/NTK 和丸和三家，上述企业在高端 HTCC 陶瓷粉体、精密管壳成型、高可靠金属化封装领域具备长期技术壁垒和渠道垄断优势。中国是全球第二大生产地区，占有大约 24.76% 的市场份额，且国内产能多集中在中低端基板及通用陶瓷配件，高端气密 HTCC 封装管壳国产化供给缺口显著。

整体来看，国内 HTCC 行业起步时间较晚，多数企业聚焦低端陶瓷制品生产，在高端气密管壳的精密成型、共烧工艺、长期可靠性控制领域技术积累缓慢，国内外高端产品技术差距明显。同时，受国际贸易环境变化和地缘政治因素影响，航空航天、卫星通信、大功率半导体、车载功率器件等战略领域高端 HTCC 管壳进口受限，产业链国产化替代进程全面加速。受制于较高的材料配方、精密工艺、可靠性认证多重行业门槛，目前国内具备高端 HTCC 陶瓷管壳批量量产能力的企业极少，现有产能和工艺水平无法满足国内多战略行业的批量采购需求，高端 HTCC 管壳成为国内高端电子产业链的薄弱环节。

公司自成立以来，一直深耕于电子陶瓷材料及射频器件产品技术的研发与生产，在电子陶瓷材料的制备工艺方面具有长期的技术积累。在材料配方方面，公司已实现 HTCC 粉体配方的自主研发，成功开发出 92/95/96/99 氧化铝等 8 种成熟配方，粉体到成品全流程自主可控，逆向工程周期长达 5 年以上。在极限工艺能力方面，公司已实现线宽/线距 50 μ m、孔径 0.1mm、单层厚度 0.1mm 的精密制造水平，良率最高可达 99.3%以上，国内仅少数厂商具备此精度，技术能力直接对标京瓷、村田等国际巨头。在端到端量产能力方面，公司已建成 HTCC 自动化产线，全流程自主完成，部分产品已进入批量交付阶段。

因此，本项目的实施，将进一步放大公司 HTCC 管壳规模化生产能力，填补国内多应用领域高端气密 HTCC 陶瓷管壳国产化供给空白，打破我国高端 HTCC 封装管壳长期依赖日系进口产品的行业格局，为航空航天、国防科工、射频通信、半导体功率器件、新能源汽车电子、光通信等多类战略产业，提供自主可控的高可靠陶瓷封装核心零部件。

（3）扩大现有 HTCC 产能规模，提升公司细分领域市场地位

从公司 HTCC 业务的增长速度来看，产能扩张的需求已经十分迫切。2024 年，公司 HTCC 业务营业收入同比增长高达 330.01%，2025 年，全年 HTCC 营业收入达到 5,057 万元，同比增长 268.62%。在短短两年间，HTCC 业务从公司的新拓业务快速成长为主要增长引擎之一，其增量速度远超公司传统主业滤波器业务。目前公司现有产线产能优先保障国防科工定制化管壳订单，民用多领域 HTCC 管壳订单已出现明显产能缺口，现有产能无法支撑下游多行业客户批量采购需求。此外，下游主要客户对 HTCC 产品的大规模量产需求正在加速释放，产能保证已成为维系和深化

客户合作的关键因素。随着下游全行业客户从样品验证转向规模化批量采购，若公司产能建设滞后，将面临优质订单流失、核心客户转单同行供应商的经营风险。

因此，先进陶瓷封装产业化项目将有效解决当前产能不足问题，支撑公司 HTCC 业务扩大量产规模，进一步巩固公司在细分领域的市场地位，并为开拓新能源、半导体、消费电子等新领域客户提供产能保障，确保公司能够及时响应下游客户加速释放的量产需求，维系和深化与核心客户的战略合作关系。

3、项目实施的可行性

（1）具有成熟完备的工艺技术，为项目构筑核心竞争壁垒

公司自成立以来，始终专注于电子陶瓷材料及射频器件的技术研发与生产制造，在材料配方、工艺优化、产品设计等方面积累了深厚的经验。在 HTCC 领域，公司已掌握关键核心技术。在材料配方中，公司针对不同应用需求，开发了多种高性能陶瓷粉体配方；在印刷工艺方面，公司具备高精度丝网印刷能力，能够确保电路图形的精确成型；在金属化工艺方面，公司实现陶瓷与金属的高可靠性共烧结合；在测试技术中，公司建立了完整的性能检测体系，保障产品一致性。此外，公司已建成全流程 HTCC 自动化生产线，具备端到端的自主生产能力，涵盖从产品设计、陶瓷材料制备到试验分析的一系列工艺流程。目前，公司已成功将多款 HTCC 光通信管壳产品从小批量试产阶段推进至批量交付阶段，充分验证了其工艺技术的成熟性和可靠性。

因此，凭借公司在电子陶瓷领域的长期技术积累，先进陶瓷封装产业化项目规模量产具备较高的技术可实现性。成熟完备的工艺技术不仅为 HTCC 产品线项目的顺利实施提供了可靠的技术基础和品质保障，更为项目投产后实现高良率、低成本、快交付的规模化运营构筑了坚实的竞争壁垒。

（2）具备完备自主的全链条生产体系，为项目提供规模量产能力保障

公司深耕电子陶瓷行业二十余年，已构建起覆盖从陶瓷粉体制备到元器件成品出厂的全链条核心技术与完备工艺体系，形成包含粉料制备、成型烧结、精密加工、金属化等 9 大核心技术能力，并掌握 180 余种介质陶瓷粉体配方。在质量管控方面，公司先后通过 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、IATF16949 汽车行业质量管理体系等权威认证，质控标准全面对标国际头部厂商，完全适配 HTCC 高端封装产品的生产要求。在生产组织方面，公司采取“以销定产”与柔性制造相结合

的模式，可根据客户多样化需求实施多品种、差异化生产，且全流程关键工序自主完成，供应链安全性与生产自主性显著优于同行业一般水平。

目前公司已将全链条自主生产体系成功落地 HTCC 管壳产品线，实现从陶瓷粉体原材料到成品封装管壳全过程自主可控。本项目将直接复制、升级公司现有成熟全链条生产体系，标准化放大 HTCC 管壳产能，实现原材料调度、工艺管控、产线生产、成品检测、仓储交付全流程闭环管理。完备的自主制造体系为本项目快速投产、稳定释放大批量产能提供坚实生产保障，有效规避上游原材料供应链波动风险，持续满足下游多领域头部客户规模化交付需求。

(3) 积累大量优质的客户资源，为项目奠定坚实市场基础

公司深耕电子陶瓷行业二十余年，凭借长期稳定的产品质量和技术创新能力，已与下游客户建立了深度互信的合作关系。公司现有客户对陶瓷封装、基板、管壳等存在明确的采购需求，因此公司生产的 HTCC 产品能够直接对接现有客户的供应链体系，快速获取相应的市场资源和客户资源。目前，公司 HTCC 相关产品线已逐步丰富，多款陶瓷基板、管壳等产品在半导体、新能源、无线通信等领域的客户开始送样，并取得阶段性进展。红外管壳已实现大批量交付，微波 SIP 开始小批量交付，DPC 陶瓷基板完成小批量交付验证，光通信管壳已进入小批量交付阶段。可见，公司 HTCC 产品已获得下游客户的初步认可，具备从样品验证向批量供货过渡的基础条件。

公司庞大的存量客户网络为 HTCC 产品提供了现成的销售渠道，而 HTCC 产品已有的送样验证和批量交付记录则证明了客户对公司技术能力和产品质量的认可。这些大量优质的客户资源、已有的 HTCC 产品市场导入成果以及公司在电子陶瓷领域树立的品牌声誉，为先进陶瓷封装产业化项目奠定了坚实的市场基础，确保项目投产后能够快速实现产能消化和销售收入增长。

4、项目投资概算

本项目计划总投资额为 20,632.31 万元，拟使用募集资金投入金额为 17,000.00 万元。项目总投资具体资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	其中：拟使用募集资金投入
1	工程建设投资	5,832.46	5,000.00
2	设备购置费用	12,075.40	12,000.00
3	项目预备费	895.39	-
4	铺底流动资金	1,829.05	-
合计		20,632.31	17,000.00

5、项目经济效益分析

经可行性论证及项目收益测算，本次募集资金投资项目具有良好的经济效益。项目实施后，能够进一步提升公司 HTCC 产品的规模化制造能力与品质保障能力，进一步丰富公司高端电子陶瓷产品结构，加快高端 HTCC 产品国产化替代步伐，持续提升企业在细分领域的市场占有率与综合竞争实力，为公司带来稳定的收入增长和现金流入。

6、建设期限以及实施主体

本项目建设期为 36 个月，实施主体为江苏灿勤科技股份有限公司。

7、项目涉及的备案、环评等事项

截至本预案公告日，本项目的备案、环评批复等报批程序尚在办理中，预计项目报批手续取得不存在实质性障碍。

（三）信息化升级与数字化工厂建设项目

1、项目概述

本项目实施主体为江苏灿勤科技股份有限公司，项目建设周期 2 年，实施地点位于张家港市后塍街道长山路 68 号、张家港保税区金港路 266 号，计划总投资 4,224.27 万元，其中拟使用募集资金投入 3,100.00 万元，主要投资内容包括工程建设投资、设备投入、软件投入、项目预备费、人员投入等必要投资。

本项目依托现有厂区与主业体系实施软硬件配套升级，通过搭建一体化数字化平台、建设 5G 工业智能基础设施及标准化数据机房，配齐数字化专业运维团队，打通全业务数据链路，实现生产全流程可视化、研发线上闭环、供应链高效协同与园区智慧运营，全方位提升生产管控精度、订单交付效率与综合成本管控能力，持

续拉高产品良率与客户供货保障水平，为公司布局 6G 射频元器件、扩大行业竞争优势提供数字化底层支撑。

2、项目实施的必要性

（1）顺应产业升级政策导向，抢抓智能制造发展红利

当前国内制造业已经全面进入数字化、智能化转型周期，自上而下的产业政策正在重塑行业准入标准与长期发展格局，企业开展工厂智能化升级不再是可选加分项，而是维持生存、实现长远发展的硬性刚需。国家出台《中国制造 2025》等顶层政策，明确要求规模制造企业加快生产数字化系统、绿色能耗管控体系落地，进而推动传统工厂向智能工厂迭代；各省市同步配套地方产业导向，将数字化改造、智能车间建设纳入制造业高质量发展核心考核指标，持续引导全行业淘汰人工粗放管理模式。

从行业发展趋势来看，上下游产业链已经形成统一转型共识，头部同行均已分批落地 MES、智能仓储、设备物联、智慧园区配套系统，依靠数字化手段实现提质、降本、控风险。如果企业维持现有传统线下管理模式，生产、研发、后勤、安全全链条管控能力将持续落后行业平均水平，逐步丢失高端客户订单、错失产业扩张机会。同时，各类政府项目申报、产业链集采招标、专精特新企业评定、绿色工厂认定，均把智能工厂软硬件建设作为基础门槛，未完成数字化改造的企业直接失去申报资格，长期丧失政策配套的资金、信贷、产业扶持资源。

本项目完整覆盖工业 5G 专网、全流程数字化软件平台、智能安防、能耗管理、工控安全、智慧后勤等一整套智能工厂建设内容，完全匹配国家及地方推动制造业智改数转的核心导向。通过本次项目落地，企业补齐数字化基础设施与管理系统短板，跟上整体产业升级节奏，具备申报各类优质产业资质的基础条件，在行业竞争、政策资源获取上建立先发优势。倘若暂缓本次智能化建设，企业将持续处于管理落后、资质缺失、竞争力不足的被动局面，因此顺应政策与行业趋势开展智能化改造具备极强必要性。

（2）完善数字化基础架构，打通全业务数据链路

目前企业数字化整体建设基础薄弱、体系零散，未搭建统一的一体化数字化管控底座，生产、研发、运营、供应链、人力等各业务系统相互割裂、数据壁垒突出，

无法实现全流程数字化协同管理。现有核心业务系统老旧、扩展性不足，无法适配智能化对接、产能扩张及精细化管理需求，部分业务仍依赖线下人工与纸质流转，存在效率低、数据不准、难以追溯等问题。同时，厂区智慧安防、能耗管控、智能后勤等基础智能化配套缺失，传统人工管理模式成本高、漏洞多、管控低效。此外，企业网络架构与安全防护体系不完善，工控防护、数据加密、安全审计能力不足，存在数据泄露、网络安全及合规性风险，整体数字化、智能化、安全建设水平无法适配企业高质量发展需求。

综上，企业数字化、智能化、安全体系建设均存在短板，现有数字化水平与企业高质量发展需求不匹配。本次项目通过升级存量系统、完善智能化配套、搭建安全防护体系，可打通全业务数据链路、破除信息壁垒，实现企业业务数字化、管理智能化、运维安全化，全面提升企业运营效率、管理水平与合规能力，为企业长远发展筑牢数字化根基，项目实施具备高度必要性与紧迫性。

（3）提质降本防控风险，提升企业综合经营效益

生产层面通过设备自动化改造、全流程无纸化生产管控、仓储智能调度，可自动完成成本核算、产能分析，减少人工统计差错，降低物料积压、生产不良带来的损耗；配套物联网能耗平台、智能节能照明，能够对水电气消耗分设备、分工序统计，综合节电率可达 35%-70%，长期持续压缩生产能耗成本。

管理层面，数字化系统将合同审批、项目管理、OA 办公、食堂结算、设备巡检等重复性工作线上自动化，可替代大量行政、仓储、后勤、安保人工岗位，长期节约人力、纸张耗材等运营支出。项目配套组建数字化专职团队，前期虽新增人力相关投入，但依托数字化转型实现全流程降本增效，长期可形成持续正向经营收益。

本项目实施将构建多层级、全覆盖的安全预警与防护体系，全方位筑牢企业经营安全防线。AI 监控可识别车间违规操作、危险闯入行为并实时告警；工业防火墙、分区网络隔离机制规避生产网络攻击；人脸门禁、车辆道闸、访客登记系统实现人车分区管控，降低园区治安隐患；配套数据加密、流量清洗、堡垒机等安全设备，分级保护财务、研发涉密数据，满足网络安全等保合规要求，全方位规避生产、园区、数据三类核心风险。

3、项目实施的可行性

(1) 政策与外部服务商资源支撑到位，落地保障充足

从政策层面来看，国家、省市两级持续出台制造业智改数转专项扶持政策，面向工业软件采购、车间自动化改造、5G 工业专网、智能机房、能耗数字化管控等场景设立专项技改补贴，配套固定资产加速折旧、设备购置所得税抵免、研发费用加计扣除等多重税收优惠，能够有效分摊项目前期大额投入，平滑分阶段资金支出，大幅减轻企业现金流压力。待项目建成投用后，企业还可申报智能工厂、数字化车间、绿色工厂、专精特新企业等官方资质，后续持续享受产业低息贷款、产业链重点扶持、人才引进配套等长效政策红利，进一步放大项目综合收益。

从实施服务商层面，本整体方案由张家港电信一体化总包交付，具备完整全站落地实施能力，可统筹 5G 定制专网、工业 PON 光纤网络、园区弱电安防、智慧后勤、机房基建、各类工业数字化软件、工控安全系统的设计、施工、联调全流程工作，企业无需分别对接网络、硬件、软件、安防多家零散供应商，有效规避多方对接产生的沟通成本、工期冲突与系统兼容风险。服务商拥有大量同类型制造工厂智能化落地成熟案例，深度熟悉制造业车间生产场景、厂区后勤管理、工业网络隔离规范，可结合企业现有产线现状定制适配方案；项目实施阶段配备驻场技术团队全程跟进施工调试，竣工后配套分层级全员操作培训，同时提供长期运维售后支撑，从项目建设到后期稳定运行形成完整服务闭环，交付风险整体可控，为项目按期落地、长期稳定投用提供坚实外部保障。

(2) 整体技术方案成熟稳定，不存在落地技术瓶颈

本项目整套技术架构均为当前制造业智能化领域经过大规模商用验证的成熟方案，各类软硬件技术路线落地案例充足，不存在前沿未商用技术带来的研发、调试风险，能够保障项目平稳落地、长期稳定运行。

底层网络采用行业通用的 5G+MEC 边缘专网结合工业 PON 光纤双架构组网模式，光纤传输介质天然具备抗电磁干扰、防雷防潮、无源稳定运行的特性，同时整体网络设计双链路冗余、核心设备单板备份，可靠性完全适配车间复杂工业环境。方案严格划分工业生产网、企业办公网、园区智能化专网，实现三张网络物理隔离，既保障生产数据独立安全，又支持按需互通，可同时承载车间海量传感器、机器人、

监控摄像头、物联网终端低时延、大并发的数据传输需求，是目前制造企业智能工厂改造的主流标准组网模式，落地经验丰富。

项目配套的 MES 生产执行、PLM 产品生命周期、WMS 智能仓储、EHR 人力资源、能耗 IOT 物联管理等数字化软件，均为工业领域标准化成熟商用产品，经过大量工厂场景迭代优化，功能完全匹配企业生产、研发、运营管理需求。所有系统预留标准化数据接口，可依托统一数据中台完成跨系统数据打通、业务联动，消除信息孤岛；配套的超融合服务器集群、工业防火墙、工控安全、数据安全防护整套架构，在众多制造企业、数据中心项目完成落地部署，工业协议解析、生产边界防护、数据加密等核心技术体系完善，能够全方位抵御网络入侵、生产数据泄露等安全风险。

在基础设施配套层面，项目同步统一规划专用机房、数据中控室土建装修工程，机房防静电、供配电、消防、综合布线等配套工程与网络、软件系统同步设计、同步施工，从源头规避后期分步改造带来的管线冲突、系统不兼容、二次返工等问题。整套方案从底层通信网络、上层业务软件、安全防护体系到机房硬件基建形成一体化完整设计，各环节技术路线相互适配、配套落地标准清晰，整体落地实施条件完备，不存在难以攻克的技术瓶颈。

(3) 企业配套条件完备，项目具备实施基础

企业覆盖生产、研发、仓储、后勤完整业务链条，厂区现有生产车间、实验室、宿舍、食堂、办公区等实体设施完备，为本项目智能化改造提供充足落地载体。本次规划的数字化软件、物联网智能硬件均可精准匹配厂区各业务场景，系统功能完全对应企业现有生产、研发、后勤业务逻辑，能够直接承接线下管理工作，不存在设备闲置、系统无业务落地的情况，大幅降低系统落地适配难度。企业内部组织架构完善，生产、研发、运营、安全、后勤各部门岗位职责清晰，可安排专职对接人员全程配合项目实施，协同服务商完成现场勘测、需求梳理、系统测试、上线试运行等全流程工作，内部协同保障充足，能够有效助力项目高效推进。

本项目数字化平台、机房、中控室、5G 工业网络底层架构均预留充足扩容空间，软件板块同步规划多项后期可拓展新增业务模块，适配企业分阶段产能扩张节奏，后续新增产线、物联网采集终端、业务管理系统时无需大规模重构底层基础设

施，一次建设即可支撑企业中长期经营发展，项目长期业务适配性良好。同时项目配置 15 名数字化专职人员，专门负责各平台上线后的日常运维、数据治理与功能迭代，叠加服务商一体化交付配套的长效售后技术支撑，形成内部自主运维、外部技术兜底的长效运营机制，能够持续保障各类软硬件系统稳定常态化运行，有效规避项目建成后运维缺位、系统闲置失效的风险。

因此，企业现有厂区载体、组织人员、业务场景、扩容能力及运维保障等内部配套条件全部齐备，能够为本项目全周期建设、长期稳定运营提供全方位支撑，进一步夯实项目落地实施基础。

4、项目投资概算

本项目计划总投资额为 4,224.27 万元，拟使用募集资金投入金额为 3,100.00 万元。项目总投资具体资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	其中：拟使用募集资金投入
1	工程建设投资	135.00	100.00
2	设备投入	159.40	-
3	软件投入	3,363.00	3,000.00
4	项目预备费	182.87	-
5	人员投入	384.00	-
合计		4,224.27	3,100.00

5、项目经济效益分析

本项目不直接产生经济效益，项目将实现厂区能耗精细化管控、生产研发流程线上闭环、园区后勤安防智慧化运行，有效降低人力运营与生产能耗成本，全面提升公司智能制造水平、研发创新效率和企业综合运营管控能力，夯实公司长期数字化发展底座，巩固在电子陶瓷元器件行业的智能化竞争优势。

6、建设期限以及实施主体

本项目建设期为 24 个月，本项目的实施主体为江苏灿勤科技股份有限公司。

7、项目涉及的备案、环评等事项

截至本预案公告日，本项目的备案等报批程序尚在办理中，预计项目报批手续取得不存在实质性障碍。

（四）补充流动资金项目

1、项目概述

本次发行拟使用募集资金 14,000.00 万元用于补充流动资金，以满足公司后续生产经营发展需要，进一步增强公司核心竞争力。

2、项目实施的必要性

随着公司主营业务规模快速扩大、应用领域持续增长，公司流动资金需求也随之增长。本次补充流动资金的规模综合考虑了公司现有的资金情况、实际运营资金需求缺口以及公司未来发展战略等因素，整体规模适当。本次募集资金部分用于补充流动资金有利于满足公司经营规模扩大所带来的营运资金需求，为公司持续快速健康发展奠定坚实的基础，优化公司财务状况，提高业务抗风险能力，维持公司快速发展的良好增长态势，有助于进一步巩固公司行业地位，提高综合竞争实力。因此，本次补充流动资金项目符合公司实际发展情况，符合全体股东利益。

3、项目实施的可行性

公司本次发行募集资金用于补充流动资金符合《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的相关要求，具有可行性。公司已根据相关法律、法规和规范性文件的规定，建立了以法人治理为核心的现代企业制度，形成了规范有效的法人治理结构和内部控制环境。为规范募集资金的管理和运用，公司建立了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、用途以及管理与监督等方面做出了明确的规定。本次发行募集资金到位后将严格按照规定存储在董事会指定的专门账户集中管理，确保本次发行的募集资金得到规范使用。

三、本次募集资金运用对公司财务状况及经营管理的影响

（一）对公司财务状况的影响

本次向特定对象发行完成后，公司的资本实力进一步增强。公司的总资产和净资产规模均会有所增长，营运资金得到进一步充实。同时，公司资金实力将有所提升，公司的资本结构将得到优化，有利于增强公司的偿债能力，降低公司的财务风

险。随着本次募投项目的顺利实施以及募集资金的有效使用，项目效益的逐步释放将提升公司运营规模 and 经济效益，从而为公司和股东带来更好的投资回报并促进公司健康发展。

（二）对公司经营管理的影响

本次募集资金投资项目主要围绕公司主营业务展开，符合国家产业政策和公司整体经营发展战略，具有良好的市场前景。本次募集资金投资项目的实施有利于实现公司业务的进一步拓展，巩固和提升公司在行业中的竞争优势，提高公司盈利能力，符合公司长期发展需求及股东利益。

四、本次募集资金投向属于科技创新领域

（一）本次募集资金主要投向科技创新领域

公司主要从事高端先进电子陶瓷元器件的研发、生产和销售，产品主要包括滤波器、天线、谐振器等元器件，并以低互调无源组件、高性能陶瓷结构与功能器件、射频模块与系统等多种产品作为补充。公司产品型号多达数千种，广泛应用于移动通信、雷达和射频电路、卫星通讯导航与定位、航空航天与国防科工、新能源、半导体、万物互联、消费电子等领域。公司自成立以来紧密跟踪通信行业发展趋势，始终坚持以技术创新作为发展核心，在高端先进电子陶瓷材料和元器件领域持续投入研发，不断推动电子陶瓷元器件技术的创新和进步。

公司本次向特定对象发行股票的募集资金投资项目包括“第六代信息技术研发及产业化项目”、“先进陶瓷封装产业化项目”、“信息化升级与数字化工厂建设项目”以及“补充流动资金项目”。其中，“第六代信息技术研发及产业化项目”的子项目“第六代信息技术产业化项目”主要针对第六代信息技术实施产能扩建，公司 6G 核心射频器件的整体供货实力将得到显著增强，市场综合竞争力持续提升，有助于进一步稳固并拓展在主流通信设备供应链中的合作份额，有力支撑国内 6G 通信关键器件国产化推进步伐；子项目“高性能电子陶瓷器件研发项目”的建设将为公司深耕高端电子陶瓷国产化赛道、突破“卡脖子”关键技术提供坚实的材料与技术支持。持续提升和完善公司在 5G-A、6G、卫星互联网、半导体、新能源汽车、工业物联网等领域的主营业务布局，进一步巩固公司通信行业电子陶瓷产品的市场地位，提升市场份额，增强盈利能力，为布局 6G 及前沿电子陶瓷产业打下坚实基础。“先进陶瓷封

装产业化项目”紧密契合国家关于推动高端电子元器件国产化替代与产业链自主可控的战略导向，是公司响应光模块、半导体封装及万物互联等领域对高性能陶瓷基板迫切需求的重要举措。通过本项目建设，公司将有效破解现阶段 HTCC 产品产能不足的发展瓶颈，解决光通信高速光模块、半导体封装、红外器件、微波集成器件等下游领域的高端 HTCC 产品供货缺口。“信息化升级与数字化工厂建设项目”将实现厂区能耗精细化管控、生产研发流程线上闭环、园区后勤安防智慧化运行，有效降低人力运营与生产能耗成本，全面提升公司智能制造水平、研发创新效率和企业综合运营管控能力，夯实公司长期数字化发展底座，巩固在电子陶瓷元器件行业的智能化竞争优势。“补充流动资金项目”主要为满足业务规模扩大带来的营运资金需求，与公司主营业务密切相关。

综上，本次募集资金主要投向科技创新领域，面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求，服务于国家创新驱动发展战略及国家经济高质量发展战略。

（二）募投项目将促进公司科技创新水平的持续提升

公司所处的通信行业具有技术壁垒高、设备投入大、人才要求高等特征。“第六代信息技术研发及产业化项目”实施完成后，公司将在显著增强 6G 核心射频器件的整体供货实力进一步稳固并拓展在主流通信设备供应链中的合作份额，有力支撑国内 6G 通信关键器件国产化推进步伐；同时通过高性能电子陶瓷器件研发，为公司完善电子陶瓷关键材料及器件产品矩阵、强化技术领先优势、提升核心竞争力筑牢基础，为公司持续深耕电子陶瓷国产化赛道、实现长远发展目标提供坚实的技术支撑与业务延伸保障。“先进陶瓷封装产业化项目”实施完成后，公司将进一步提升 HTCC 产品的规模化制造能力与品质保障能力，满足下游客户对高端封装器件的严苛标准，进一步丰富公司高端电子陶瓷产品结构，加快高端 HTCC 产品国产化替代步伐。“信息化升级与数字化工厂建设项目”实施完成后，将实现生产全流程可视化、研发线上闭环、供应链高效协同与园区智慧运营，全方位提升生产管控精度、订单交付效率与综合成本管控能力，持续拉高产品良率与客户供货保障水平，为公司布局 6G 射频元器件、扩大行业竞争优势提供数字化底层支撑。

综上所述，公司本次募集资金投资项目将进一步提升公司在电子陶瓷元器件领域的研发和生产能力，促进公司科技创新水平的持续提升。

第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况

（一）本次发行对公司业务及资产的影响

公司本次向特定对象发行股票募集资金扣除相关发行费用后将用于“第六代信息技术研发及产业化项目”、“先进陶瓷封装产业化项目”、“信息化升级与数字化工厂建设项目”以及“补充流动资金项目”，符合公司的业务发展方向和战略布局。

本次募投项目与公司现有业务将产生显著的协同效应，符合国家相关的产业政策和公司未来整体战略发展方向，系对公司主营业务的升级和进一步拓展，是公司完善产业布局的重要举措，具有良好的市场发展前景和经济效益。本次向特定对象发行股票的募集资金投资项目围绕公司主营业务开展，本次发行完成后，公司业务结构不会产生重大变化。公司不存在因本次发行而导致的业务及资产整合计划。

（二）本次发行对公司章程的影响

本次发行完成后，公司的股本总额将相应增加，公司将按照发行的实际情况对《公司章程》中与股本相关的条款进行修改，并办理工商变更登记。除此之外，本次发行不会对公司章程造成影响。

（三）本次发行对公司股东结构的影响

本次发行完成后，公司的股本规模、股东结构及持股比例将发生变化，本次发行不会导致公司实际控制人发生变化。本次发行完成后，公司股权分布仍符合上市条件。

（四）本次发行对高管人员结构的影响

截至本预案公告日，公司尚无调整高级管理人员的计划，本次发行亦不会对高级管理人员结构造成重大影响。本次发行完成后，若公司拟调整高级管理人员，将会严格履行必要的法律程序和信息披露义务。

（五）本次发行对业务结构的影响

公司本次发行募集资金投向全部围绕公司现有主营业务展开，项目实施后将增强公司主营业务的收入规模与盈利能力，不会导致公司业务结构发生重大变化。

二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

（一）本次发行对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司的总资产与净资产规模将同时增加，资金实力将有所提升，公司整体财务状况将得到一定程度的提高，财务结构趋向合理与优化，有利于增强公司抵御财务风险的能力。

（二）本次发行对公司盈利能力的影响

本次发行完成后，公司的总股本及净资产规模有所增加，但募集资金投资项目实施并产生效益需要一定周期，因此本次发行募集资金到位后短期内可能会导致净资产收益率、每股收益等指标出现一定程度的下降。

但本次募集资金投资项目系基于公司现有主营业务，综合考虑市场需求及发展战略而选择实施，长期来看有助于公司提升核心竞争能力，提升未来公司经营业绩和盈利能力。

（三）本次发行对公司现金流量的影响

本次发行完成后，募集资金到位将使得公司筹资活动产生的现金流入金额大幅增加；在募集资金具体投入项目后，投资活动产生的现金流出金额也将大幅增加；随着募投项目的实施和效益产生，公司盈利能力不断增强，经营活动产生的现金流入金额将逐步增加。

三、公司与实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人未发生变化。本次发行完成后，公司与实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系等不会发生重大变化。本次向特定对象发行也不会导致公司与实际控制人及其关联人之间新增同业竞争或关联交易。

四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被实际控制人及其关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形

截至本预案公告日，公司不存在资金、资产被控股股东及实际控制人以及其控制的其他企业占用的情况，亦不存在为控股股东及实际控制人以及其控制的其他企业违规提供担保的情形。公司亦不会因本次发行而产生资金、资产被控股股东及实际控制人以及其控制的其他企业占用以及为其违规提供担保的情况。

五、本次发行对公司负债情况的影响

本次发行完成后，公司的总资产和净资产将同时增加，公司的资产负债率将有所下降，不存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况。公司的资产负债结构将更趋合理，抵御风险能力将进一步增强，符合公司全体股东的利益。

六、本次股票发行相关的风险说明

（一）本次向特定对象发行 A 股股票的相关风险

1、审批风险

本次向特定对象发行 A 股股票方案尚需获得公司股东会审议通过、上交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后方可实施。该等审批事项的结果以及所需的时间均存在不确定性。

2、发行风险

由于本次发行为向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集资金，发行结果将受到证券市场整体情况、公司股票价格走势、投资者对本次发行方案的认可程度等多种内外部因素的影响，因此，本次向特定对象发行股票存在募集资金不足甚至发行失败的风险。

3、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险

由于本次向特定对象发行股票募集资金到位后公司的总股本和净资产规模将会增加，而募集资金投资项目效益的产生需要一定时间周期，在募集资金投资项目产生效益之前，公司的利润实现和股东回报仍主要通过现有业务实现，因此，本次向特定对象发行股票可能会导致公司的即期回报在短期内有所摊薄。

此外，若公司本次向特定对象发行股票募集资金投资项目未能实现预期效益，进而导致公司未来的业务规模和利润水平未能相应增长，则公司的每股收益、净资产收益率等财务指标将出现一定幅度的下降。特此提醒投资者关注本次向特定对象发行股票可能摊薄即期回报的风险。

（二）募集资金投资项目风险

1、募投项目实施后产能不能及时消化、无法实现预期效益的风险

公司本次募投项目将新增公司滤波器、HTCC 产品产能。未来整体市场环境、供求关系尚存在不确定性，若在募投项目实施过程中宏观经济、产业政策、市场环境等发生重大不利变化，产品技术路线发生重大更替，或公司市场开拓不利、无法满足下游客户需求或其他不可抗力因素出现，都可能对公司募投项目的顺利实施、产能消化造成不利影响，甚至导致募集资金投资项目的实际效益不及预期的风险。

2、募投项目固定资产折旧增加导致利润下滑的风险

本次募集资金投资项目实施后，公司固定资产规模将大幅提高，资产结构也将发生较大变化。若募集资金投资项目不能按照计划产生效益以弥补新增固定资产投资产生的折旧，将在一定程度上影响公司净利润，因此公司面临固定资产折旧增加导致的利润下滑的风险。

3、募投项目所需备案和环评批复尚未取得的风险

截至本预案公告日，公司尚未取得本次发行募投项目建设所需备案和环评批复。目前，相关审批程序已在有序推进，公司如果未来不能按预期进度顺利取得相关备案和批复，可能对相应募投项目的实施进度造成不利影响。

（三）经营风险

1、下游市场需求波动的风险

下游移动运营商的资本开支波动对产业链上游通信设备制造商的经营业绩具有显著影响，若 5G 及新一代移动信息网络商业化进程不及预期、以及运营商的生产经营压力增大、运营商对 5G 及新一代移动信息网络的资本开支下降、建设进度放缓，并进而导致公司主要客户对公司的产品需求下降，公司的经营业绩将因此受到影响。

2、技术升级和更新迭代较快的风险

通信行业发展迅速，从 2G、3G、4G、5G 到 5G-A，每隔 5-10 年就会出现一次大规模的技术升级和更新迭代。3G/4G 通信中，通信基站主要采用传统金属腔体滤波器，5G 通信 Massive MIMO 技术和有源天线技术的运用使陶瓷介质波导滤波器成为构造基站 AAU 的重要技术方案之一。未来，随着移动通信行业技术的迭代升级和新技术、新应用的出现，若公司不能准确跟踪产品技术和市场发展的趋势，并及时响应客户需求研发出适应新技术的产品，公司将会丧失市场竞争力，由此对持续盈利能力产生不利影响。

3、项目推进未达到预期的风险

为及时抓住市场发展机遇，提高公司核心竞争力、加强抗风险能力，公司保持积极态度筹划与推进一系列项目建设。但在项目建设进程中，受行政审批、资金筹措、规划调整等多重因素影响，项目建设进度可能不及预期；同时，公司的项目建设具有前瞻性，受宏观经济、市场竞争、行业政策变化等多重因素影响，公司新项目经济效益的实现周期存在不确定性。

（四）技术研发风险

1、核心技术泄密或核心技术人员流失的风险

公司自成立以来，坚持以技术创新为发展核心，紧密跟踪电子陶瓷行业发展趋势，在电子陶瓷材料和元器件领域持续投入研发，形成了包括先进微波介质陶瓷材料配方及制备技术、复杂陶瓷体一次成型技术、盲孔陶瓷体金属化及银焊技术等在内的大量核心技术。如果未来核心技术不慎泄密或出现核心技术人员流失的状况，有可能影响公司的持续研发能力，对公司的市场竞争力和盈利能力造成不利影响。

2、研发失败或产业化不及预期的风险

作为未来三年的发展规划，公司将继续以电子陶瓷材料及元器件技术为基础，深耕射频通信领域，牢抓万物互联等契机，成为全球电子陶瓷行业的领先者。公司目前的在研项目将对未来的发展起重要作用。截至 2025 年 12 月 31 日，公司在研项目包括高 Q 值 K65 微波介质材料的研发、120W 超高功率介质波导滤波器的开发、三维 MEMS 芯片制作技术等。尽管公司研发项目均直接面向客户需求和市场发展趋势，但由于研发成功与否本身具有不确定性，研发成果的市场应用前景也具有不确

定性，公司的研发项目存在研发失败或无法在短期内实现产业化应用的风险，投入的研发费用在短期内也存在无法得到经济利益回报的风险。

第四节 利润分配政策及执行情况

一、公司利润分配政策

为完善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》等相关规定，公司已有完善的股利分配政策，在《公司章程》中制定了有关利润分配和现金分红政策如下：

“第一百六十二条 公司的利润分配政策为：

（一）利润分配原则：公司在不影响正常经营和持续发展的前提下，实施持续、稳定、积极的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、审计委员会和股东会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、公众投资者的意见。

原则上公司每年进行一次利润分配，主要以现金分红为主，但公司可以根据公司盈利情况及资金需求状况进行中期利润分配。

（二）利润分配形式：公司采取现金、股票或者两者相结合的方式分配利润，并优先推行以现金方式分配利润。

（三）利润分配周期：公司一般按年度进行利润分配，在有条件的情况下，董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期利润分配。在满足现金分红条件情况下，公司应采取现金方式进行利润分配，原则上每年度进行一次现金分红，也可以进行中期现金分红。公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

（四）公司现金股利政策目标为按照本章程规定的现金分红的条件和要求进行分红。

（五）现金分红的条件：在同时满足下列条件时，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配：

1、公司上一年度实现的可分配利润为正值，即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润为正值；

2、公司累计可供分配利润为正值；

3、审计机构对公司的上一年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。

上述重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：

1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 3,000 万元；

2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

（六）现金分红的最低金额或比例

公司具备现金分红条件的，应当采取现金方式分配利润，每年度现金分红比例不低于当年实现的可供分配利润的 10%。

（七）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按公司章程进行现金分红安排：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大投资计划或重大现金支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大投资计划或重大现金支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大投资计划或重大现金支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大投资计划或重大现金支出安排时，按照前项规定处理。重大资金支出安排指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%，且超过 5000 万元。

（八）股票股利分配的条件：以给予股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素，公司可以采取股票股利分配的方式进行利润分配。

（九）当存在以下情形时，公司可以不进行利润分配：

1、最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见；

2、当年末资产负债率高于 70%；

3、当年经营性现金流为负。

（十）利润分配政策的决策机制和程序：

1、公司的利润分配政策由董事会拟定，提请股东会审议。

2、审计委员会应当对提请股东会审议的利润分配政策进行审核并出具书面审核意见。

3、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。董事会认为需要调整利润分配政策时，可以提交利润分配政策调整方案供股东会审议，公司可以采取网络投票方式等方式为中小股东参加股东会提供便利。

（十一）利润分配方案的决策机制和程序：

1、公司每年利润分配具体方案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议公告中披露独立董事的意见及未采纳的具体理由。

2、股东会应根据法律法规和本章程的规定对董事会提出的利润分配预案进行表决。股东会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

3、如公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配具体方案的，应当在年度报告中披露具体原因。公司当年利润分配方案应当经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4、审计委员会应对董事会执行公司现金分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。审计委员会发现董事会存在未严格执行现金分红政策和股东回报规划、未严格履行相应决策程序或未能真实、准确、完整进行相应信息披露的，应当发表明确意见，并督促其及时改正。

（十二）既定利润分配政策的调整：公司如因外部经营环境、自身经营状况发生重大变化，或由于国家法律、法规或政策发生变化而需要调整利润分配政策的，详细论证和说明调整的原因，并根据本章程履行内部决策程序，由公司董事会提交议案并经股东会审议，经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（十三）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

二、公司最近三年股利分配情况

公司最近三年股利分配情况如下：

（一）2023 年度利润分配方案

2024 年 5 月 14 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，该次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 400,000,000 股为基数，每股派发现金红利 0.05875 元（含税），共计派发现金红利 23,500,000.00 元。

（二）2024 年度利润分配方案

2025 年 4 月 28 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，该次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 400,000,000 股为基数，每股派发现金红利 0.075 元（含税），共计派发现金红利 30,000,000 元。

（三）2025 年中期利润分配方案

2026 年 1 月 15 日，公司 2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于公司 2025 年中期利润分配方案的议案》，该次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 400,000,000 股为基数，每股派发现金红利 0.0375 元（含税），共计派发现金红利 15,000,000 元。

（四）2025 年度利润分配方案

2026 年 5 月 11 日，公司 2025 年年度股东会审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》，该次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 400,000,000 股为基数，每股派发现金红利 0.0625 元（含税），共计派发现金红利 25,000,000 元。

公司最近三年利润分配情况汇总如下：

单位：万元

项目	2025年	2024年	2023年
合并报表中归属于上市公司股东的净利润	12,036.28	5,779.43	4,673.56
现金分红金额（含税）	4,000.00	3,000.00	2,350.00
现金分红占归属于上市公司股东的净利润的比例	33.23%	51.91%	50.28%
最近三年累计现金分红金额	9,350.00		
最近三年实现的年均可分配利润	7,496.42		
最近三年累计现金分红金额占最近三年实现的年均可分配利润的比例	124.73%		

三、公司最近三年未分配利润使用情况

为保持公司的可持续发展，公司最近三年实现的归属于上市公司股东的净利润在提取法定盈余公积金及向股东分红后，当年剩余的未分配利润结转至下一年度，主要用于公司日常的生产经营，以支持公司未来战略规划和可持续性发展。公司未分配利润的使用安排符合公司的实际情况和公司全体股东利益。

四、公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划

为进一步健全和完善江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，保护投资者合法权益，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》等有关法律法规、规范性文件及

《江苏灿勤科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，并结合公司的实际情况，制订了《江苏灿勤科技股份有限公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》（以下简称“股东回报规划”），具体如下：

（一）股东回报规划制定考虑因素

公司的利润分配着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司战略发展目标、股东意愿的基础上，结合公司的盈利情况和现金流量状况、经营发展规划及企业所处的发展阶段、资金需求情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素，依据《公司章程》要求，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，并对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

（二）股东回报规划制定遵循原则

股东回报规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》中利润分配相关条款的规定，重视对投资者的合理投资回报且兼顾公司实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

（三）未来三年（2026 年-2028 年）的具体股东回报规划

1、利润分配形式

公司采取现金、股票或者两者相结合的方式分配利润，并优先推行以现金方式分配利润。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。

公司一般按年度进行利润分配，在有条件的情况下，董事会也可以根据公司的资金需求状况提议进行中期现金分红。在采用股票股利进行利润分配时，公司应当以给予股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提，应当充分考虑成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

2、利润分配条件

（1）现金分红的条件

在同时满足下列条件时，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配：

①公司上一年度实现的可分配利润为正值，即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润为正值；

②公司累计可供分配利润为正值；

③审计机构对公司的上一年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（中期利润分配按证监会、上交所有关规定执行）；

④公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。

上述重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：

①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 3,000 万元；

②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

公司具备现金分红条件的，应当采取现金方式分配利润，每年度现金分红比例不低于当年实现的可供分配利润的 10%。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按《公司章程》进行现金分红安排：

①公司发展阶段属成熟期且无重大投资计划或重大现金支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

②公司发展阶段属成熟期且有重大投资计划或重大现金支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

③公司发展阶段属成长期且有重大投资计划或重大现金支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大投资计划或重大现金支出安排时，按照前项规定处理。

（2）股票股利分配的条件

以给予股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素，公司可以采取股票股利分配的方式进行利润分配。

3、利润分配方案的决策机制和程序

（1）公司每年利润分配具体方案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议公告中披露独立董事的意见及未采纳的具体理由。

（2）股东会应根据法律法规和本章程的规定对董事会提出的利润分配预案进行表决。股东会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

（3）如公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配具体方案的，应当在年度报告中披露具体原因。公司当年利润分配方案应当经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（4）审计委员会应对董事会执行公司现金分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。审计委员会发现董事会存在未严格执行现金分红政策和股东回报规划、未严格履行相应决策程序或未能真实、准确、完整进行相应信息披露的，应当发表明确意见，并督促其及时改正。

（四）股东回报规划的制定周期和决策机制

1、公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划，并根据《公司章程》确定的利润分配政策及公司经营的实际情况，对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的公司股东回报规划。

2、公司董事会在制定股东回报规划时，应结合公司具体经营情况，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，以保护股东特别是中小股东权益并兼顾公司长期可持续发展为基础进行详细论证，充分听取股东特别是中小股东和独立董事的意见，经董事会审议通过并提交公司股东会审议通过后实施。

3、如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要对公司既定的股东回报规划进行调整的，由董事会制订有关议案，相关议案经董事会审议后提交股东会，并经股东会以特别决议审议通过。调整后的股东回报规划不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。公司董事会在研究论证调整股东回报规划的过程中，应当充分考虑独立董事和中小股东的意见。

（五）其他事项

股东回报规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日实施。本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。

第五节 本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报分析

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）的相关要求，公司就本次向特定对象发行 A 股股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，具体措施说明如下：

一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

公司本次拟向特定对象发行股票数量不超过 120,000,000 股（含本数），募集资金规模不超过 85,100.00 万元（含本数）。本次发行完成后，公司的总股本和净资产将会大幅增加。

基于上述情况，按照本次发行股份数量及募集资金的上限，公司测算了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响。

（一）主要假设和前提条件

以下假设仅为测算本次发行对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。相关假设如下：

1、假设宏观经济环境、行业发展状况、产业政策、证券行业情况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大不利变化。

2、假设本次发行于 2027 年 1 月末完成（此假设仅用于分析本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不构成对本次向特定对象发行股票实际完成时间的判断），最终完成时间以中国证监会同意注册后实际发行完成时间为准。

3、公司 2025 年经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 8,320.44 万元。假设 2026 年度、2027 年度归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别较上年度持平、增长 10%和增长 20%三种情况测算。

4、假设本次向特定对象发行股票募集资金总额为 85,100.00 万元（含本数），实际到账的募集资金规模将根据监管部门批准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。

5、2025 年 12 月 31 日公司总股本为 400,000,000 股，假设本次发行前公司总股本不变、本次向特定对象发行股票股份数量为 120,000,000 股（以预案出具日公司总股本的 30%测算）。此假设仅用于测算本次发行对公司每股收益的影响，不代表公司对本次实际发行股份数量的判断，最终以本次发行获得上海证券交易所审核通过以及中国证监会同意注册并实际发行股份数量为准。

6、在预测及计算 2026 年度、2027 年度相关数据及指标时，仅考虑本次向特定对象发行股票和净利润的影响，不考虑其他因素（如资本公积转增股本、股权激励、股票回购注销、可转债转股等）对公司总股本的影响。

7、未考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响。

8、假设不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等方面的影响。

（二）对公司主要财务指标的影响分析

基于上述假设前提，本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响情况如下表：

单位：万股、万元、元/股

项目	2025 年度 /2025.12.31	2026 年度 /2026.12.31	2027 年度/2027.12.31	
			本次发行前	本次发行后
总股本（万股）	40,000.00	40,000.00	40,000.00	52,000.00
假设一：公司 2026 年度、2027 年度归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与上年度持平				
归属于公司普通股股东的净利润（万元）	12,036.28	12,036.28	12,036.28	12,036.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（万元）	8,320.44	8,320.44	8,320.44	8,320.44
基本每股收益（元/股）	0.30	0.30	0.30	0.24
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.21	0.21	0.21	0.16
假设二：公司 2026 年度、2027 年度归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较上年度增长 10%				

项目	2025 年度 /2025.12.31	2026 年度 /2026.12.31	2027 年度/2027.12.31	
			本次发行前	本次发行后
归属于公司普通股股东的净利润（万元）	12,036.28	13,239.91	14,563.90	14,563.90
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（万元）	8,320.44	9,152.48	10,067.73	10,067.73
基本每股收益（元/股）	0.30	0.33	0.36	0.29
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.21	0.23	0.25	0.20
假设三：公司 2026 年度、2027 年度归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较上年度增长 20%				
归属于公司普通股股东的净利润（万元）	12,036.28	14,443.54	17,332.24	17,332.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（万元）	8,320.44	9,984.53	11,981.43	11,981.43
基本每股收益（元/股）	0.30	0.36	0.43	0.34
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.21	0.25	0.30	0.23

注：基本每股收益、稀释每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定计算

二、本次发行摊薄即期回报的风险提示

本次发行募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会相应增加，由于募集资金投资项目存在一定的建设期，不能在短期内实现预期效益，因此短期内公司净利润增长幅度可能会低于净资产和总股本的增长幅度，预计本次发行后公司的每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标将出现一定幅度的下降，股东即期回报存在被摊薄的风险。

特此提醒投资者关注本次发行可能摊薄即期股东回报的风险。

三、本次向特定对象发行股票的必要性和合理性

本次募集资金投资项目有利于公司扩大业务规模，提高行业地位，增强公司核心竞争力及盈利能力。本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策，以及公司所处行业发展趋势和未来发展战略，具有良好的市场前景和经济效益，符合公司及公司全体股东的利益。具体情况详见本预案“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”部分。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司本次发行募集资金投向全部围绕公司现有主营业务展开，本次募集资金投资项目基于公司在技术和市场方面的积累，与本公司现有主业紧密相关，募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展规划，具有良好的市场发展前景和经济效益，有利于提高公司在电子陶瓷元器件领域的研发和生产能力，持续增强公司的核心竞争力和盈利能力。

（二）公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

本次发行的募集资金投资项目均经过了详细的论证。公司在人员、技术、市场等方面都进行了充分的准备，公司具备募集资金投资项目的综合执行能力，具体详见本预案“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”。

五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

考虑到本次向特定对象发行股票对普通股股东即期回报摊薄的影响，为保护投资者利益，填补本次向特定对象发行股票可能导致的即期回报减少，公司承诺将采取多项措施保证募集资金有效使用，有效防范即期回报被摊薄的风险，并提高未来的回报能力，具体如下：

（一）加强募集资金管理，确保募集资金规范和有效使用

公司将根据相关法律、法规和《募集资金管理制度》的相关要求，规范募集资金的管理与使用，确保本次募集资金专项用于募投项目，公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《江苏灿勤科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实际情况，制定了募集资金管理制度，明确规定公司对募集资金采用专户专储、专款专用的制度，以便于募集资金的管理和使用，并对其使用情况加以监督。公司将定期检查募集资金使用情况，保证募集资金专款专用，确保募集资金按照既定用途得到有效使用。

（二）加强经营管理，提升经营效益

本次发行募集资金到位后，公司将继续提高内部运营管理水平，持续优化业务流程和内部控制制度，降低公司运营成本，提升公司资产运营效率。此外，公司将持续推动人才发展体系建设，优化激励机制，激发全体公司员工的工作积极性和创造力。通过上述举措，提升公司的运营效率、降低成本，提升公司的经营效益。

（三）积极推进公司发展战略，提高公司的竞争力

本次募集资金投资项目基于公司主营业务展开，符合国家有关产业政策和行业发展趋势。本次募集资金投资项目建成达产后，公司产能及销售规模将进一步扩大，有利于提升公司市场份额、竞争力和可持续发展能力。本次募集资金到位前，公司将积极调配资源，充分做好募投项目开展的筹备工作；募集资金到位后，公司将合理推进募集资金投资项目的实施，提高资金使用效率，以维护全体股东的长远利益，降低本次发行对股东即期回报摊薄的风险。

（四）完善利润分配政策，重视投资者回报

为健全和完善公司科学、持续、稳定、透明的分红政策和监督机制，积极有效地回报投资者，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》等规定，公司已经制定和完善了《公司章程》中有关利润分配的相关条款，明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。本次发行后，公司将严格执行利润分配规定，切实保障投资者合法权益。

六、公司的董事、高级管理人员以及公司控股股东、实际控制人关于本次发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。

为维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报拟采取的措施得到切实履行做出了承诺，具体如下：

（一）公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行做出的承诺

公司董事、高级管理人员为保证公司填补回报措施能够得到切实履行，承诺如下：

1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不会采用其他方式损害公司利益；

2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；

3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

4、承诺支持公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、承诺若公司实施股权激励的，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、本人切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，如违反本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任；

7、自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行 A 股股票实施完毕前，若中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求，且上述承诺不能满足证券监管机构该等新的监管规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。

（二）控股股东、实际控制人出具的承诺

公司控股股东、实际控制人为保证公司填补回报措施能够得到切实履行，承诺如下：

1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

2、切实履行公司制定的有关填补回报相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，如本公司/本人违反前述承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任；

3、自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行 A 股股票实施完毕前，如中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求，且上述承诺不能满足证券监管机构该等新的监管规定时，本公司/本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。

江苏灿勤科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 15 日